

股票代號(Stock Code):3661



Alchip Technologies, Limited
英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司

一百一十三年度年報
2024 Annual Report

刊 印 日 期：2025 年 3 月 31 日
年 報 網 址：<https://mops.twse.com.tw>
世芯電子網站：<https://www.alchip.com>

一、公司發言人及代理發言人、中華民國境內訴訟及非訴訟代理人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

本公司發言人		代理發言人		訴訟及非訴訟代理人	
姓名：	王德善	姓名：	沈翔霖	姓名：	王德善
職稱：	財務長	職稱：	執行長	職稱：	財務長
電話：	02-2659-9357	電話：	02-2799-2318	電話：	02-2659-9357
電子郵件信箱：	IR@alchip.com	電子郵件信箱：	IR@alchip.com	電子郵件信箱：	IR@alchip.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

公司名稱	地址	電話
1. 總公司： Alchip Technologies, Limited 英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY-1104, Cayman Islands	886-2-2799-2318
2. 臺灣分公司： 英屬開曼群島商世芯股份有限公司臺灣分公司	臺北市內湖區文湖街12號9樓	886-2-2799-2318
3. 臺灣子公司： 世芯電子股份有限公司	臺北市內湖區文湖街12號9樓	886-2-2799-2318
4. 香港子公司： Alchip Technologies, Limited	Room 509, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road Central, Hong Kong	852-2522-2922
5. 上海孫公司： 世芯電子(上海)有限公司	註冊地址： 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區平莊東路1221號11幢 營運地址： 上海市徐匯區龍華中路596號綠地中心東樓11樓	86-21-52350999
6. 日本子公司： アルチップ・テクノロジーズ株式会社 (Alchip Technologies, K.K.)	10F Shin-Yokohama Square Bldg, 2-3-12 Shin-Yokohama, Kouhoku Yokohama, Kanagawa Japan, 222-0033	81-45-470-1090
7. 美國子公司： AlChip Technologies, Inc.	2107 N 1st St., Suite 570, San Jose, CA 95131	1-408-320-2223
8. 無錫孫公司： 世芯電子科技(無錫)有限公司	無錫市濱湖區建築西路777號A5幢4樓	86-510-85120332
9. BVI子公司： Alchip Investment Inc.	Portcullis TrustNet Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110	886-2-2799-2318
10. 合肥孫公司： 捷芯科技(合肥)有限公司	合肥市高新區望江西路800號合肥創新產業園C4樓605-610室	86-551-65655001
11. 濟南孫公司： 濟南世芯電子科技有限公司	山東省濟南市高新區舜華路1000號齊魯軟件園2號樓(創業廣場B座)一層	86-531-89017990
12. 廣州孫公司： 世芯電子科技(廣州)有限公司	廣東省廣州市黃埔區科學大道18號芯大廈1201室	86-20-89819302
13. 重慶孫公司： 世芯電子科技(重慶)有限公司	重慶市北碚區雲漢大道142號7層	86-23-86970666
14. 矽雲孫公司： 矽雲(上海)科技有限公司	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區新楊公路1588號4幢	86-137-61232125
15. 馬來西亞子公司： Alchip Technologies Malaysia Sdn. Bhd.	Unit No.20, Level 20, Menara Centara, No.360 Jalantuanaku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur Malaysia	886-2-2799-2318
16. 越南孫公司： Alchip Technologies (Vietnam) Company Limited	64 Nguyen Dinh Chieu Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam	84-02862751199

三、董事會名單

職稱	姓名	國籍	主要經(學)歷	
董事長	關建英	美國、中華民國	學歷	美國伊利諾大學電子工程學士
			經歷	本公司總經理 Altius Solutions 創辦人
董事	張國威	中華民國	學歷	交通大學管理科學碩士
			經歷	牧東光電(股)公司總經理
董事	王德善	中華民國	學歷	美國紐約市立大學柏魯克分校碩士
			經歷	富邦證券上海代表處代表
董事	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang Lin	美國、中華民國	學歷	美國加州大學洛杉磯分校電子工程學士
			經歷	本公司營運長
獨立董事	江善頌	中華民國	學歷	美國南加州大學企業管理碩士
			經歷	華登國際管理顧問(股)公司董事總經理
獨立董事	洪茂蔚	中華民國	學歷	美國西北大學財務金融博士 美國威斯康辛麥迪遜大學經濟碩士
			經歷	臺灣大學國企系教授 台灣金融研訓院董事長
獨立董事	莊彬甫	美國	學歷	美國奧勒岡州立大學理工學士 台灣交通大學理工學士
			經歷	上海新茂半導體有限公司董事兼總經理

四、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：中國信託商業銀行代理部	網址： https://www.ctbcbank.com
地址：台北市重慶南路一段83號5樓	電話：(02)6636-5566

五、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：王儀雯會計師、張麗君會計師	事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所	網址： https://www.deloitte.com.tw
地址：臺北市信義區松仁路100號20樓	電話：02-2725-9988	

六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：盧森堡證券交易所
查詢該海外有價證券資訊之方式：<https://www.bourse.lu/security/US0137412021/327168>

七、公司網址：<https://www.alchip.com>

目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	3
一、公司簡介	3
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	12
四、公司治理運作情形.....	18
五、簽證會計師公費資訊.....	48
六、更換會計師資訊.....	48
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師事務所或關係企業	49
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	49
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊.....	51
十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	52
參、募資情形.....	54
一、資本及股份、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證及併購（包括合併、收購及分割）之辦理情形.....	54
二、資金運用計劃執行情形，包括計畫內容及執行情形	69
肆、營運概況.....	70
一、業務內容	70
二、市場及產銷概況.....	74
三、從業員工	80
四、環保支出資訊.....	80
五、勞資關係	80
六、資通安全管理.....	82
七、重要契約	84
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	86
一、財務狀況分析.....	86
二、財務績效分析.....	87
三、現金流量	88
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	88
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃	88
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項評估	89
七、其他重要事項	91
陸、特別記載事項.....	92
一、關係企業相關資料.....	92
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	96
三、其他必要補充說明事項.....	97
四、本公司章程與我國股東權益保障規定重大差異之說明	98
五、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	113

壹、 致股東報告書

各位股東女士、先生們：

世芯電子作為全球領先的 ASIC（特殊應用積體電路）設計服務公司，專注於高效能計算（HPC）和人工智慧（AI）領域，為客戶提供尖端系統單晶片（SoC）解決方案，涵蓋從晶片設計到製造的全價值鏈一站式服務。世芯電子秉持"創新為本、誠信經營、品質至上、團隊合作"的核心價值，致力於成為業界最可靠的 ASIC 合作夥伴。

2024 年半導體行業迎來轉型關鍵期，人工智慧的快速普及與高效能運算需求的急遽增長成為行業發展的主要推動力。世芯電子把握此市場機遇，營收創下歷史新高，於高效能運算及人工智慧領域皆取得亮眼成績，HPC 及 AI 設計案在北美和亞太地區持續增長。同時，在車用電子專案亦取得重大突破，進一步鞏固其在先進 ASIC 設計領域的領導地位。

值得關注的是，世芯電子於 2024 年進行數個重要 AI 相關晶片的解決方案，從雲端服務商客戶的 AI 加速晶片的設計到 AI 邊緣運算晶片的設計專案皆為世芯電子重點布局的方向，除此之外、世芯電子通過與主流車廠戰略合作，正式進入汽車 ADAS 市場，實現高增長領域的重要佈局。

在先進封裝技術方面，公司已完成多項 5 奈米及 3 奈米應用 2.5D CoWoS 封裝設計案並完成流片，預計將於 2025-2026 年陸續進入量產階段。憑藉在 7 奈米、5 奈米、3 奈米等先進製程節點上的深厚積累，以及 CoWoS 和 3DIC 等先進封裝解決方案的技術實力，世芯電子成功確立了自己在複雜 SoC 開發領域的領導地位。

無論在營收或獲利的部分，2024 年可謂是豐收的一年。依應用別來說、AI 和 HPC 相關應用貢獻公司 94% 營收；依製程來看，公司 97% 收入來自先進製程設計（7 奈米及以下），各項相關數據充分彰顯公司之技術領導地位，結合即將進入量產的多項重大項目，相信世芯電子能夠在快速變化且競爭激烈的 ASIC 市場中持續創造價值。

營業結果

以新臺幣計，2024 年本公司營業額為新臺幣五百一十九億六仟九佰萬元，較 2023 年的營業額新臺幣三百零四億八仟二佰萬元成長 70%，2024 年稅後淨利為新臺幣六十四億五仟萬元，較 2023 年的稅後淨利新臺幣三十三億二仟萬元增加 94%。以美元來計算，全年營收為一十六億一仟八佰萬美元，稅後淨利為二億美元，分別較前一年增加 65% 及 88%。2024 年經營績效的表現包括：全年平均毛利率 20%、營業利益率為 13%、資產報酬率為 16%、權益報酬率為 22%。成長動能主要來自對北美雲端服務客戶之 7 奈米人工智慧晶片出貨強勁，帶動整體營收與獲利顯著增長。此外，稅後淨利成長幅度優於營收，反映公司營運效率持續提升，以及利息收入增加所帶動的業外收益成長。

另本公司未對外公告財務預測，年度預算僅供內部經營管理分析之用。

技術創新

著眼於客戶對產品性能更卓越、更低耗電及晶片尺寸更小的需求，2024 年世芯電子持續投入資源發展高階製程晶片設計、3DIC 先進封裝設計平台與客製化 IP，加強與合作夥伴合作，共同致力於先進技術的優化研發，例如導入最新的 SoW(System on Wafer)、WoW(Wafer on Wafer)設計與封裝技術。

目前世芯電子已成功投片多項 5 奈米、3 奈米人工智慧及高效能運算設計案及先進的 2.5D/3D 封裝技術並進入量產，亦有 3 奈米和 2 奈米晶片設計案正進行中。所有團隊已就定位，幫助客戶搶得市場先機，領先推出最尖端的產品，確立我們在先進製程設計服務的領導

地位。

預期銷售數量與其依據

展望 2025 年，隨著 7 奈米 AI 晶片對北美客戶的出貨逐步結束，整體銷售表現預期將趨於平穩。然而，NRE（委託設計）需求與專案開發動能仍維持強勁，AI 及網路相關應用的需求持續攀升，製程技術也將從 7 奈米/5 奈米逐步邁向 5 奈米/3 奈米節點。2025 年將啟動多個 2 奈米專案，預期更具優勢的產品組合將有助於進一步提升整體獲利率。

企業發展

為進一步提升服務品質與業務發展需求，世芯電子持續擴張企業版圖，將營運力道深入北美、日本、臺灣和東南亞地區，為與日俱增的業務需求提供更即時完善的服務。隨著市場的需求擴張，世芯將以具國際水準的先進製程設計能力及優秀的團隊，期望未來成為 ASIC 設計產業第一領導品牌。

未來展望

展望 2025 年，我們會不斷以創新技術、先進製程設計、尖端研發實力及策略聯盟開拓市場先機。在產品方面，我們將著重於高效能運算、人工智慧、與車用電子等領域之應用，把握半導體產業變革機遇，推動持續增長；在技術層面，公司將重點突破 3DIC 小晶片架構、創新型 IO 小晶片方案及 1.6 奈米等下一代製程技術，保持創新領先地位；在戰略佈局方面，我們將加大北美市場投入，深化與主要系統廠商及雲服務廠商的戰略聯盟，鞏固公司在半導體產業中可信賴 ASIC 合作夥伴的地位，並持續以堅強的核心競爭力及使命必達的信念，爭取客戶信任以提供高品質的客戶服務，邁向持續成長及獲利之目標，為客戶及股東創造更高的價值。

最後，再次誠摯地感謝努力不懈的員工，和各位股東們長久以來對本公司的支持與鼓勵，謹致上最深的謝忱！

並祝各位，身體健康、萬事如意

董事長：關建英



貳、 公司治理報告

一、 公司簡介

(一) 設立時間及集團簡介

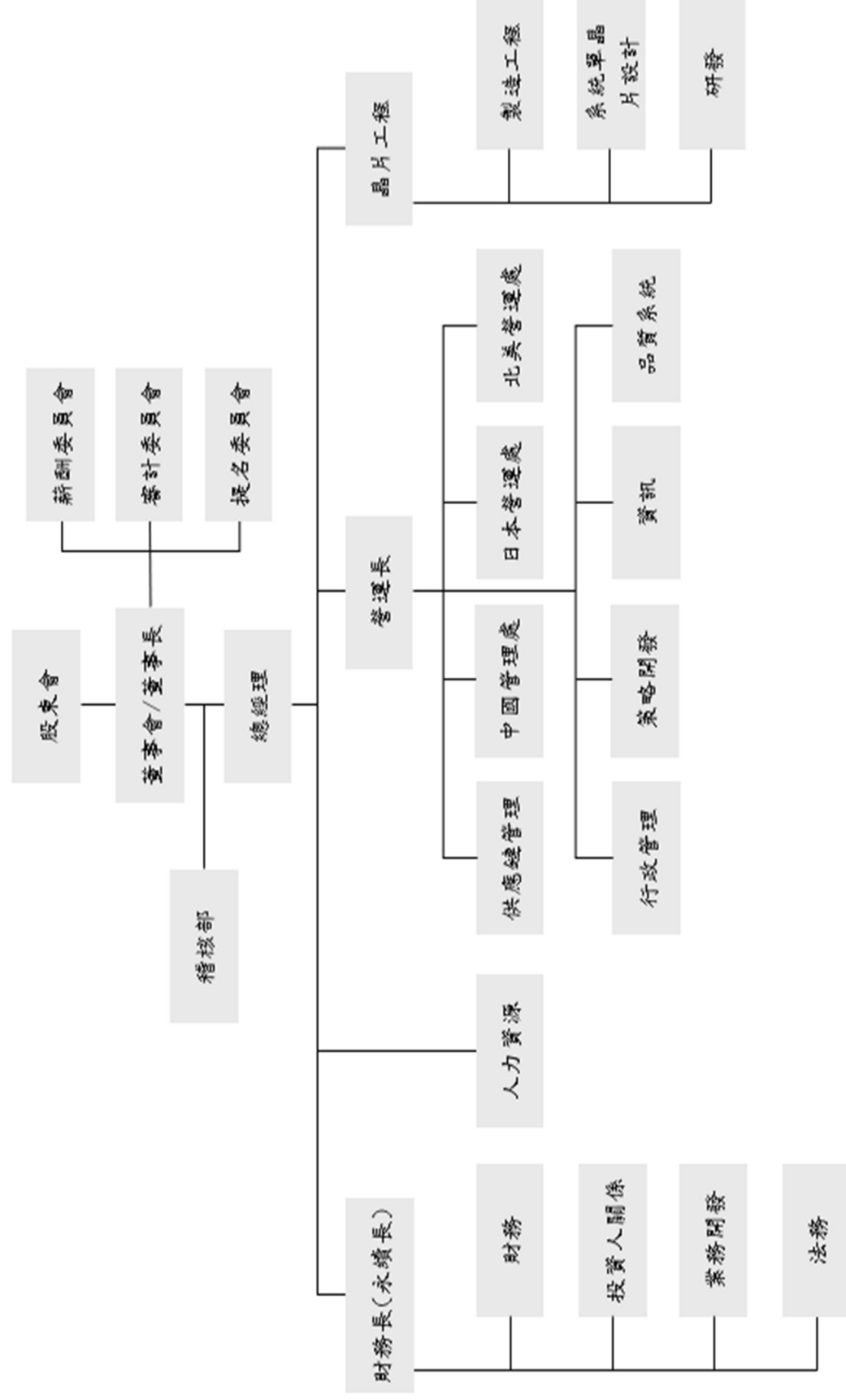
世芯電子股份有限公司（以下稱「本公司」或「世芯電子」），係由董事長關建英先生帶領來自美國矽谷知名系統單晶片公司的核心技術團隊，於 2003 年 2 月 27 日設立於英屬開曼群島，為專門提供高複雜度、高產量特殊應用積體電路(ASIC)與系統單晶片(SoC)設計及製造服務的領導業者。總部設於臺灣臺北，新竹設有 ASIC 製造中心；基於全球發展策略考量，本公司分別在中國、日本和美國成立子公司（以下合稱「本集團」）。截至 2025 年底，員工總人數為 597 人。

本集團之經營團隊在 IC 設計服務產業深耕多年，團隊包含來自美國矽穀與日本的 SoC 設計專家，平均具有 25 年以上半導體產業管理經驗，在先進製程及晶片設計的能力優於其他同業。在成立之初的短短三年間，就完成了從 0.13 微米、90 奈米至 65 奈米的技術跨度並付諸量產；2009 年開始為客戶量產 40 奈米設計案；2013 年跨入 28 奈米設計案；2016 年及 2017 年更完成了數件 28 奈米、16 奈米超級電腦設計案；2018 年至 2020 年間完成多項 7 至 12 奈米高效能運算製程設計案；2021 年投片多項 7 奈米人工智慧應用設計案並成功進入量產；2022 年投片多項採用先進封裝製程技術的 7 奈米、6 奈米和 5 奈米設計專案。4 奈米設計測試晶片亦已完成投片；2023 年第一季成功完成 3 奈米投片，2024 年完成-完成 2 奈米測試晶片並成功投片。截至 2024 年底，世芯電子投片眾多 7 奈米、6 奈米、5 奈米和 3 奈米設計，其中更有多項使用 CoWoS 和 InFO 先進封裝技術。

世芯電子專注於 FinFET 製程（16 奈米及以下）的 ASIC 及 SoC 解決方案，目標在於協助系統產品客戶在最短時間完成低成本、高複雜度的晶片設計，以加速客戶產品上市。公司成立至今，已完成超過五百顆高端製程 SoC，終端產品應用領域分為三大類，包含人工智慧/高效能運算/通訊網絡設備、消費性電子產品（高解析度電視、數位相機、娛樂系統、行動寬頻...等）以及利基型產品（醫療設備與監視系統...等），世芯電子在上述的應用領域中創造出傲人的成績，與此同時亦開始進入車用晶片相關領域，是眾多世界級系統大廠 IC 設計夥伴之首選。

本集團之組織架構，請參照年報第六章第一項之關係企業組織圖。關於風險事項，請參閱年報第五章第六項最近年度及截至年報刊印日止風險事項評估。

(二) 集團架構



二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一) 董事資料

2025 年 3 月 31 日

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職 務	具配偶或以 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人 關係		備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
董事長	美國、 中華民國	關建英	男 61~70 歲	2022/6/10	3	2003/2/27	431,000	0.60%	260,000	0.32%	0	0%	0	0%	學歷： ■美國伊利諾大學計算機 工程學士 經歷： ■本公司總經理 ■Altius Solutions 創辦人	■本公司臺灣子公司董事 ■本公司日本子公司董事 ■本公司香港子公司董事	無	無	
董事	美國、 中華民國	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	男 51~60 歲	2022/06/10	3	2011/5/18	1,441,652	2.02%	1,721,652	2.13%	0	0%	0	0%	學歷： ■美國加州大學洛杉磯分 校電子工程學士 經歷： ■本公司營運長 (COO)	■本公司臺灣子公司總經理人 ■本公司臺灣分公司經理人 ■本公司美國子公司董事 ■本公司無錫孫公司董事 ■本公司合肥孫公司監事 ■本公司濟南孫公司監事 ■本公司廣州孫公司監事 ■本公司重慶孫公司董事	無	無	
董事	中華民國	王德善	男 41~50 歲	2022/6/10	3	2019/6/21	200,000	0.28%	100,000	0.12%	200,000	0.25%	0	0%	學歷： ■美國紐約市立大學柏魯 克分校碩士 經歷： ■富邦證券上海代表處代 表	■本公司 BVI 子公司董事 ■本公司無錫孫公司董事 ■本公司合肥孫公司董事 ■本公司濟南孫公司董事 ■本公司廣州孫公司董事 ■本公司矽雲孫公司董事 ■本公司馬來西亞子公司董事 ■本公司越南孫公司董事長	無	無	

獨立董事	美國、中華民國	莊彬甫	男 71~80歲	2022/6/10	3	2010/11/25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷： ■美國奧勒岡州立大學理工碩士 ■臺灣交通大學理工學士 經歷： ■上海新茂半導體有限公司董事兼總經理	無	無	無	無
------	---------	-----	-------------	-----------	---	------------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	---	---

(二) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格 與經驗 (註 1)	獨立性情形 (註 2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
關建英		關建英先生於美國伊利諾大學取得計算機工程學士學位，並在美國矽谷創立 Altius Solutions 公司，此公司於 2001 年與知名 EDA 公司 Simplex Solutions 合併並上市。關建英先生具有半導體科技產業發展之遠見，在 2002 年創辦世芯電子，將過往豐富的研發能力與卓越的領導能力，帶入世芯電子營運管理中。 關建英先生未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
張國威		張國威先生於國立交通大學(現改名國立陽明交通大學)取得管理科學碩士學位。張國威先生在創投界有超過 25 年的投資管理經歷，專注於 IC 設計、半導體、網路通訊、網際網路、電腦軟體及其他高科技相關產業；他已主導投資多個個案成功上市並曾擔任多家臺灣及美國掛牌科技公司董事。他於 1996 年至 2015 年間擔任旭揚創業投資股份有限公司總經理並自 1998 年起擔任 GrowStar Partners Group Limited 的管理合夥人，具有國際視野與科技產業管理經驗。 張國威先生未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0

沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	沈翔霖先生於美國加州大學洛杉磯分校取得電子工程學士學位，擁有超過 25 年的 IC 產業及管理經驗，1999 年加入董事長關建英先生創立的 Altius Solutions 公司。2002 年與董事長關建英先生共同創立本公司，並於 2012 年起擔任世芯電子執行長。他在 IC 產業相關營運規劃、商務、財務會計或是在經營與管理實務上都有非常豐富的經驗及卓越的能力。 沈翔霖先生未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
王德善	王德善先生擁有美國紐約市大柏魯克學院 MBA 學位及加州科技大學電腦資訊管理碩士，曾擔任富邦證券上海代表處代表，證券科技產業分析師等職位，具備豐富的財務分析、產業研究、投資經驗、投資人關係與經營管理實務能力。 王德善先生未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
洪茂蔚	洪茂蔚先生除了擁有臺灣大學經濟學學士，並取得美國威斯康辛麥迪遜大學經濟碩士與美國西北大學財務金融博士學位。他曾任教於美國西北大學與加拿大麥基爾大學，目前在臺灣大學擔任講座教授，其財務會計專長與公司治理能力兼備。因此，在執行獨立董事職權時，能提升董事會公司治理品質、審計委員會與薪酬委員會監督功能。 洪茂蔚先生未有公司法第 30 條各款情事。	洪茂蔚先生為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2
江善頌	江善頌先生於美國南加州大學取得企業管理碩士學位。曾於 New Idea Electronic Corporation 擔任市場總監一職，現任華登國際管理顧問(股)公司董事總經理，主要負責電子及半導體行業方面業務。江善頌先生熟稔半導體產業，具備在公司治理、財務會計、商務、市場行銷及產業科技等領域之分析及管理能力，能提升董事會公司治理品質、審計委員會與薪酬委員會監督功能。 江善頌先生未有公司法第 30 條各款情事。	江善頌先生為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

莊彬甫	莊彬甫先生擁有美國奧勒岡州立大學理工碩士學位。曾任職上海新茂半導體有限公司董事兼總經理。莊彬甫先生專注於半導體產業之經營與策略管理多年，具備公司治理、商務及產業科技能力，能提升董事會公司治理品質、審計委員會與薪酬委員會監督功能。 莊彬甫先生未有公司法第 30 條各款情事。	莊彬甫先生為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
-----	---	--	---

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(三) 董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化：本公司之「公司治理實務守則」已明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、年齡、國籍及文化，除應具備執行業務所必需之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力等多元化專業背景。本公司現任董事成員共 7 位(含 3 位獨立董事)，包含 2 名具員工身份董事(佔全體董事成員比例為 28.6%)。本公司尚無女性董事，為強化董事會多元化目標，預計 2025 年改選董事時，會增設女性董事，以增進董事會組成成員之性別平等。截至 2024 年底，有 1 位董事年齡在 41~50 歲，其他董事年齡皆為 50 歲以上；各董事之性別、專業資格、工作經驗及多元化情形等相關資訊，請參閱參、公司治理報告之二、董事資料。
2. 董事會獨立性：本公司現任董事成員共 7 位，包含 3 位獨立董事(佔全體董事成員比例為 42.9%)，獨立董事皆無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，獨立董事間無配偶及二親等以內之親屬關係，均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。

(四) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

2025 年 3 月 31 日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
執行長	美國、中華民國	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	男	2010/1/1	1,721,652	2.13%	0	0%	0	0%	學歷： ■ 美國加州大學洛杉磯分校電子工程學士 經歷： ■ 本公司營運長 (COO)	■ 本公司臺灣子公司總經理 ■ 本公司臺灣分公司經理人 ■ 本公司美國子公司董事 ■ 本公司無錫孫公司董事 ■ 本公司合肥孫公司監事 ■ 本公司濟南孫公司監事 ■ 本公司廣州孫公司監事 ■ 本公司重慶孫公司董事 ■ 本公司無錫孫公司董事長及總經理 ■ 本公司合肥孫公司董事長及總經理 ■ 本公司濟南孫公司董事長及總經理 ■ 本公司上海孫公司董事長及總經理 ■ 本公司廣州孫公司董事長及總經理 ■ 本公司重慶孫公司董事長及總經理 ■ 本公司矽雲孫公司董事	無	無	無	
副總經理	中華民國	林志堅	男	2016/11/11	224,167	0.28%	0	0%	0	0%	學歷： ■ 英國牛津大學企業管理碩士 ■ 臺灣大學企業管理學士 經歷： ■ Logitech Electronic Ltd. 全球客戶業務經理	■ 本公司無錫孫公司董事長及總經理 ■ 本公司合肥孫公司董事長及總經理 ■ 本公司濟南孫公司董事長及總經理 ■ 本公司上海孫公司董事長及總經理 ■ 本公司廣州孫公司董事長及總經理 ■ 本公司重慶孫公司董事長及總經理 ■ 本公司矽雲孫公司董事	無	無	無	
副總經理	日本	古園 博幸 Furuzono, Hiroyuki	男	2022/3/4	40,000	0.05%	0	0%	0	0%	學歷： ■ 日本早稻田大學理工學士 經歷： ■ Cadence Design Systems, Inc. 單晶片設計工程師 ■ Altius Solutions, Inc. 單晶片設計工程師	■ 本公司日本子公司董事長、總經理及董事	無	無	無	
資深副總經理	中華民國	黃耀林	男	2021/3/5	275,000	0.34%	0	0%	0	0%	學歷： ■ 北卡羅萊納州立大學材料科學與工程學系博士 ■ 維吉尼亞理工大學碩士 經歷： ■ 台灣精體電路製造股份有限公司市場部資深經理 ■ 創意電子行銷業務副總經理	■ 本公司美國子公司總經理	無	無	無	
資深副總經理	中華民國、加拿大	鄭永力	男	2012/8/15	170,187	0.21%	0	0%	0	0%	學歷： ■ 美國南加州大學電機工程碩士	■ 本公司無錫孫公司董事 ■ 本公司合肥孫公司董事 ■ 本公司濟南孫公司董事 ■ 本公司廣州孫公司董事	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
											經歷： ■ Cirrus Logic Inc. 資深工程師 ■ Stream Machine Company 工程師	■ 本公司重慶孫公司董事 ■ 本公司矽雲孫公司董事 ■ 本公司馬來西亞子公司董事 ■ 本公司越南孫公司董事			
副總經理	中華民國	張政淵	男	2017/11/3	153,250	0.19%	0	0%	0	0%	學歷： ■ 東吳大學企業管理學士 經歷： ■ 巨集國際半導體股份有限公司業務協理 ■ 福懋科技股份有限公司業務經理	無	無	無	
財務長	中華民國	王德善	男	2011/12/29	100,000	0.12%	200,000	0.25%	0	0%	學歷： ■ 美國紐約市立大學柏魯克分校碩士 經歷： ■ 富邦證券上海代表處代表	■ 本公司 BVI 子公司董事 ■ 本公司無錫孫公司董事 ■ 本公司合肥孫公司董事 ■ 本公司濟南孫公司董事 ■ 本公司廣州孫公司董事 ■ 本公司矽雲孫公司董事 ■ 本公司馬來西亞子公司董事 ■ 本公司越南孫公司董事長	無	無	
副總經理	中華民國、加拿大	鄧建成	男	2019/3/15	112,671	0.14%	0	0%	0	0%	學歷： ■ 加拿大多倫多大學資訊工程學士 經歷： ■ ATI Technologies Inc. 工程師	■ 本公司馬來西亞子公司董事 ■ 本公司越南孫公司董事	無	無	
會計主管	中國	金曉煒(註 2)	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
會計主管	中華民國	詹舒媚(註 3)	女	2024/09/01	128,000	0.16%	0	0%	0	0%	學歷： ■ 英國瑞汀大學 (ISMA) 風險管理碩士 ■ 台灣大學會計學士 經歷： ■ 勤業眾信聯合會計師事務所副理	■ 本公司 BVI 子公司董事	無	無	

註 1：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無此情事。

註 2：金曉煒女士於 2024 年 9 月 1 日卸任經理人。

註 3：詹舒媚女士於 2024 年 9 月 1 日新任經理人。

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 董事(含獨立董事)之酬金：

2024年12月31日;單位:新臺幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D四項總額		A、B、C及D四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G七項總額		A、B、C、D、E、F及G七項總額占稅後純益之比例		領取來自子公司以外之轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)(註1)	業務執行費用(D)	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	薪資、獎金及特支費等(E)	本公司	財務報告內所有公司	員工酬勞(G)		本公司	財務報告內所有公司		
													現金酬勞金額	股票紅利金額			現金酬勞金額	
董事長	關建英					本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			本公司	財務報告內所有公司			
董事	張國威					本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			本公司	財務報告內所有公司			
董事	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang -Lin					本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			本公司	財務報告內所有公司			
董事	王德善	8,113	-	48,168	2,312	58,593	0.91%	96,141	103	-	-	-	-	154,837	2.40%	2.40%	無	
獨立董事	洪茂蔚																	
獨立董事	江善頌																	
獨立董事	莊彬甫																	

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董監酬勞係依照公司章程規定，本公司當年度如有獲利，應提撥不高於2%為董事酬勞，董事支領出席會議之車馬費係經董事會通過按月支領薪資。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名				
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)		
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
低於 1,000,000 元	-	-	-	-	
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	-	-	
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-	
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	張國威、洪茂蔚、江善頌、莊彬甫、王德善、沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	張國威、洪茂蔚、江善頌、莊彬甫、王德善、沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	張國威、洪茂蔚、江善頌、莊彬甫	張國威、洪茂蔚、江善頌、莊彬甫	
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-	
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	關建英	關建英	關建英	關建英	
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-			
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	王德善	王德善	
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	
100,000,000 元以上	-	-	-	-	
總計	7	7	7	7	

2. 監察人之酬金：本公司未設置監察人，故不適用。

3. 總經理及副總經理之酬金：

2024年12月31日;單位:新臺幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D項總額		A、B、C及D項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金酬勞金額	股票紅利金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
執行長	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin															
財務長	王德善															
資深副總經理	鄭永力															
副總經理	張政淵															
副總經理	鄧建成	283,195	283,195	1,165	1,165	-	-	-	-	-	-	284,360	284,360	4.41%	4.41%	無
副總經理	古園 博幸 Furuzono, Hiroyuki															
資深副總經理	黃耀林															
副總經理	林志堅															
會計主管	金曉煒(註 1)															
會計主管	詹舒媚(註 2)															

註 1：金曉煒女士於 2024 年 9 月 1 日卸任會計主管。

註 2：詹舒媚女士於 2024 年 9 月 1 日新任會計主管。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	金曉煒	金曉煒
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	古園 博幸 Furuzono, Hiroyuki、詹舒媚	古園 博幸 Furuzono, Hiroyuki、詹舒媚
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	林志堅、黃耀林、鄧建成	林志堅、黃耀林、鄧建成
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	王德善、張政淵、鄭永力	王德善、張政淵、鄭永力
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin
100,000,000 元以上	-	-
總計	10	10

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

2024 年 12 月 31 日;單位:新臺幣仟元						
	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經	執行長	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin				
	副總經理	古園 博幸 Furuzono, Hiroyuki				
	資深副總經理	黃耀林				
	副總經理	林志堅				
	資深副總經理	鄭永力				
理	副總經理	張政淵	0	0	0	0%
	財務長	王德善				
	副總經理	鄧建成				
	會計主管	金曉煒(註 1)				
	會計主管	詹舒媚(註 2)				
人						

註 1：金曉煒女士於 2024 年 9 月 1 日卸任會計主管。
 註 2：詹舒媚女士於 2024 年 9 月 1 日新任會計主管。

5. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占合併稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：

(1) 本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占合併稅後純益比例之分析：

項目	酬金總額占合併稅後純益比例			
	2023 年度		2024 年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董 事	1.48%	1.48%	0.91%	0.91%
總 經 理 及 副 總 經 理	8.75%	8.75%	4.41%	4.41%

(2) 給付酬金之政策、標準及組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

- (a) 董事之酬金，係根據其在本公司擔任之職位、對本公司營運參與程度及貢獻與董事績效評估結果作為核發酬金之依據。其績效評估內容包含六大項：公司目標與任務掌握、董事職責認知、公司營運參與程度、內部關係定期審視、董事之專業及持續進修、內部控制、推動公司永續發展目標(環境、社會、公司治理面向)等，給予合理報酬，該報酬之金額應由薪酬委員會建議並提請董事會決定，且應參酌董事對公司之服務範圍、價值及國內外同業之水準給付，依公司章程規定以不超過公司當年度獲利的 2%為原則。
- (b) 經理人(含總經理及副總經理)之酬金之給付標準，係依員工所擔任之職務、對公司的營運成果貢獻度、個別的績效表現 (依其年度目標達成度及部門領導管理績效)、永續發展目標(環境、社會、公司治理面向) 達成率等因素，參考業界薪酬標準並考量公司未來風險計算其酬金，經薪酬委員會個別審議評估後送董事會決定，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。為激勵高階經理人重視公司長期綜合績效表現，達到永續發展的目標，自 2024 年起將公司永續發展策略與目標和高階經理人的激勵制度連結，依永續目標達成狀況做為最終績效考核成果的加減分項目，以滿分的正負 5%為限。

總經理及副總經理的 ESG KPI 如下：

永續發展目標	ESG KPI
環境	• 減少溫室氣體排放 • 能源多元化，增加再生能源使用
社會	• 人才培育與發展 • 職場多元化與人權保障 • 職業安全與衛生
公司治理	• 誠信經營透明治理 • 綠色供應鏈管理 • 董事會多元化

(c) 與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司已成立薪資報酬委員會，支付董事、經理人(含總經理及副總經理)之酬金，由薪資報酬委員會依其學經歷、參考同業通常水準、對公司貢獻程度及經營績效、同時考量本公司未來可能面臨之營運風險、交易風險及財務風險等因素訂定，並按相關管理辦法辦理。薪資報酬委員會至少每年召開一次會議檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構評估並訂定董事、經理人之薪資報酬，將評估結果提出建議，再提交董事會討論，故不致產生重大未來風險。

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊：

本公司 2024 年度及截至年報刊印日止，董事會共開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 席次數(B)	委託出席次數	實際出席 (B/A) (%)	席率	備註
董事長	關建英	7	0	100%		
董事	張國威	7	0	100%		
董事	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	7	0	100%		
董事	王德善	7	0	100%		
獨立董事	洪茂蔚	7	0	100%		
獨立董事	江善頌	7	0	100%		
獨立董事	莊彬甫	7	0	100%		

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會 日期	期別	議案內容	獨立董事 意見	公司對獨立董 事意見之處理
2024 年 3 月 1 日	2024 年 第 1 次	- 核認本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 - 通過本公司董事 2024 年每月報酬及業務執行費用案。 - 通過本公司以 Alchip Investment, Inc. 投資 Adoresys Pte. Ltd. 案。 - 通過本公司 2023 年度第一次員工認股權憑證發行及授予名冊。 - 通過解除董事競業禁止之限制案。	無	無
2024 年 4 月 16 日	2024 年 第 2 次	- 通過本公司辦理私募普通股案。 - 通過解除董事競業禁止之限制案。	無	無
2024 年 5 月 3 日	2024 年 第 3 次	- 通過本公司 BVI 子公司增資案。 - 通過本公司發行 2024 年員工認股權憑證案。	無	無
2024 年	2024 年第 1 次	通過本公司 112 年股東常會決議辦理之私募普通股案不繼續辦理募集發行案。	無	無

5月14日	臨時			
2024年 8月23日	2024年 第4次	- 通過本公司會計主管變動案。 - 通過本公司追認2024年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。 - 通過本公司2024年度第一次員工認股權憑證發行及授予名冊案。	無	無
2024年 11月1日	2024年 第5次	- 通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任案。 - 通過本公司增訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」、「風險管理政策」、「內部控制制度及內稽實施細則-永續資訊之管理」與「誠信經營實務守則」案。 - 通過本公司2024年度第二次員工認股權憑證發行及授予名冊案。	無	無
2025年 2月27日	2025年 第1次	- 核認本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 - 通過本公司董事2025年每月報酬及業務執行費用案。 - 通過勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。 - 通過全面改選董事(含獨立董事)案。 - 通過新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案。	無	無

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、議案內容、利益迴避原因以及參與表決情形：沈翔霖董事與王德善董事於2024年3月1日與2025年2月27日董事會之高階經理人薪酬案因利益迴避，未參與討論及表決。

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	董事會2024年1月1日至2024年10月31日之績效進行評估	董事會及個別董事成員	董事會內部自評、董事成員自評	已於2024年第四季完成評估，董事會評估包含下列面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修與內部控制等。而董事會成員自評包含以下面向：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修與內部控制。評估結果介於5分「非常同意」與4分「同意」之間，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會整體運作良好。

每三年	2023 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 12 日	董事會與各功能性委員會	外部專業獨立機構執行評估	財團法人台北金融研究發展基金會評估委員認為本公司董事會整體運作遵循主管機關相關規範並提供以下四點建議。 1.受評公司為健全公司治理制度，宜優先制定與關係人相互間之財務業務相關作業規範，並於網站揭露以維護股東權益。 2.受評公司現有獨立董事連任任期已超過三屆，建議下期董事會可適度改選，並考量納入女性董事，以強化董事會職能與多元化。 3.為因應受評公司整體成長快速，宜擬定董事及管理階層完整且明確之接班培育計畫，定期進行檢視與彈性調整，並可適度於網站揭露。 4.受評公司營運逐年成長，風險控管應更趨健全，建議可適度增加稽核、資訊安全人力；面對永續發展國際趨勢，也可考慮調整財務長兼任公司治理督導，落實公司治理相關業務。			
-----	---------------------------------	-------------	--------------	--	--	--	--

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
為健全董事會監督功能及強化管理機制，本公司於2010年10月29日成立審計委員會，並於2011年5月18日設置薪資報酬委員會，以提昇董事會運作效能。
為落實公司治理並提升董事會績效，本公司於2020年3月6日訂定「董事會績效評估辦法」，並每年進行績效評估。

五、董事會獨立董事出席狀況：

◎:親自出席; ☆:委託出席; * :未出席

期別 姓名	2024 年 第 1 次	2024 年 第 2 次	2024 年 第 3 次	2024 年 第 4 次	2024 年 第 5 次	2024 年 第 6 次	2025 年 第 1 次
洪茂蔚	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
江善頌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
莊彬甫	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

(二) 審計委員會運作情形資訊：

2024年度及截至年報刊印日止，審計委員會開會 7次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	洪茂蔚	7	0	100%	
獨立董事	江善頌	7	0	100%	
獨立董事	莊彬甫	7	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之年度工作重點：審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。

•審閱財務報告

本公司造具 2024 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本公司審計委員會查核，認為尚無不合。

•評估內部控制制度之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理階層的定期報告，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

•委任簽證會計師

為了確保簽證會計師事務所之獨立性及適任性，本公司參照會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」及審計品質指標（AQIs）之內容，就會計師之獨立性及適任性進行評估。經 2024 年 11 月 1 日及 2025 年 2 月 27 日審計委員會審議並通過勤業眾信聯合會計師事務所劉建良會計師及張麗君會計師均符合獨立性及適任性標準。

二、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會召開日期	期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
2024 年 3 月 1 日	2024 年 第 1 次	• 核認本公司 2023 年度合併財務報表案。 • 核認本公司 2023 年度盈餘分配案。 • 核認本公司 2023 年營業報告書案。	無	全體委員同意通過	無

			- 核認本公司 2023 年度內部控制聲明書。 - 通過本公司參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性案。 - 通過本公司以 Alchip Investment, Inc.投資 Adoresys Pte. Ltd. 案。 - 通過本公司 2023 年度第一次員工認股權憑證發行及授予名冊案。 - 通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」與「股東會議事規則」案。			
2024 年 4 月 16 日	2024 年 第 2 次	- 通過本公司成立越南子公司案。 - 通過本公司私募普通股案。	無	全體委員同意通過	無	
2024 年 5 月 3 日	2024 年 第 3 次	- 核認本公司 2024 年第一季合併財務報表。 - 通過本公司 BVI 子公司增資案。 - 通過本公司發行 2024 年員工認股權憑證案。	無	全體委員同意通過	無	
2024 年 5 月 14 日	2024 年 第 1 次臨時	通過本公司 112 年股東常會決議辦理之私募普通股案擬不繼續辦理募集發行案。	無	全體委員同意通過	無	
2024 年 8 月 23 日	2024 年 第 4 次	- 通過本公司 2024 年第二季財務報表案。 - 通過本公司訂定「人權政策」、修訂「董事會績效評估辦法」與「誠信經營作業程序及行為指南」案。 - 通過本公司 2024 年度第一次員工認股權憑證發行及授予名冊案。	無	全體委員同意通過	無	
2024 年 11 月 1 日	2024 年 第 5 次	- 核認本公司 2024 年第三季合併財務報表案。 - 通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任案。 - 通過本公司 2025 年稽核計畫案。 - 通過本公司增訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」、「風險管理政策」、「內部控制制度及內稽實施細則-永續資訊之管理」與「誠信經營實務守則」案。 - 通過本公司修訂「公司治理實務守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」案。 - 通過本公司 2024 年度第二次員工認股權憑證發行及授予名冊案。	無	全體委員同意通過	無	
2025 年	2025 年	核認本公司 2024 年度合併財務報表案。	無	全體委員同意通過	無	

2月27日	第1次	- 核認本公司2024年度盈餘分配案。 - 核認本公司2024年營業報告書案。 - 核認本公司2024年度內部控制聲明書。 - 通過勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。 - 通過本公司參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性案。 - 通過本公司訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案。		意通過
-------	-----	---	--	-----

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

三、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
內部稽核主管每月呈交稽核報告予各獨立董事查閱，並於每季的審計委員會及董事會議中報告稽核執行情形，若有特殊狀況時，內部稽核主管將即時通知審計委員會委員。

2024年度至年報刊印日止獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下表：

日期	溝通內容	溝通情形
2024年3月1日 審計委員會	2023年第4季內部稽核業務查核報告	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形，溝通情形良好。
2024年5月3日 審計委員會	2024年第1季內部稽核業務查核報告	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形，溝通情形良好。
2024年8月23日 審計委員會	2024年第2季內部稽核業務查核報告	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形，溝通情形良好。
2024年11月1日 審計委員會	2024年第3季內部稽核業務查核報告	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形，溝通情形良好。
2025年2月27日 審計委員會	2024年第4季內部稽核業務查核報告	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形，溝通情形良好。

本公司簽證會計師於2025年2月27日的審計委員會中報告2024年度財務報告查核結果以及其他相關法令要求之溝通事項，獨立董事與會計師溝通狀況良好。

2024年度至年報刊印日止獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要如下表：

日期	溝通內容	溝通情形
2024年3月1日 審計委員會	1. 2023年度合併財務報告查核結果並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。 2. 內控查核情形報告。	本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。

2025 年 2 月 27 日 審計委員會	1. 2024 年度合併財務報告查核結果並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。 2. 內控查核情形報告。	本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。
-----------------------	--	----------------------

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」及考量公司運作及實際需要，訂定「公司治理實務守則」並經董事會通過後，揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	尚無重大差異。

項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、公司股權結構及股東權益				
1. 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		1. 由發言人負責處理股東之建議或糾紛等事宜，並協調公司相關單位執行。	尚無重大差異。
2. 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形。	V		2. 本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上大股東之持股情形。	尚無重大差異。
3. 公司是否建立、執行與關係企業風險控管機制及防火牆機制？	V		3. 本公司訂有「集團、特定公司及關係人交易作業程序」，明確劃分與各關係企業間之人員、資產、財務管理權責，各關係企業間建立獨立之財務系統，並經內部檢核機制，確實執行風險控管及防火牆機制。	尚無重大差異。
4. 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		4. 為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易處理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並定期向公司內部人適時提供教育宣導。本公司另於「公司治理實務守則」內，規範內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。	尚無重大差異。

項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、董事會之組成及職責 1. 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		1. 本公司設有七席董事，其中三席為獨立董事且依照「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定辦理，本公司之「公司治理實務守則」已說明董事會成員組成多元化之方針，每位董事都各自具備其專業背景及產業經歷等，以達公司治理之理想目標。 本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與2024年度達成情形概述如下： (1)就基本條件與價值方面，現任董事會成員皆有臺灣國籍，其中三位具美國籍身份。本公司目前7位董事中，尚無女性董事，為強化董事會多元化目標，2025年改選董事時，會增設至少一名女性董事，以增進董事會組成成員之性別平等。 (2)就專業知識與技能方面，董事會成員以兼具財務或會計、經營管理及產業知識等多面向為目標，目前董事會之組成已具備所需之各項專業資格。本公司2024年度董事會成員多元化落實情形如下表：	尚無重大差異。

[illegible]

「獨立聲明書」，評估本公司簽證會計師符合本公司獨立性評估標準(請參閱下表說明)。最近一次評估經2024年11月1日及2025年2月27日經審計委員會通過決議通過後提報同日董事會決議通過。			
評估項目	評估結果	是否符合獨立性	
審計小組成員及其配偶與受扶養親屬是否與本公司直接或重大間接財務利益關係	否	是	
審計小組成員及其配偶與受扶養親屬是否與本公司或本公司之董事、經理人間，有影響獨立性之商業關係	否	是	
審計期間，審計小組成員及其配偶與受扶養親屬是否擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務	否	是	
審計小組成員與本公司之董事、經理人是否有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係	否	是	
審計小組成員是否收受本公司或本公司之董事、經理人或主要股東價值重大之餽贈或禮物(其價值未超越一般社交禮儀標準)。	否	是	
審計小組成員執行必要之獨立性/利益衝突程序，是否發現有違反獨立性情事或未解決之利益衝突	否	是	

項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		本公司設有兼職單位負責提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等相關公司治理事務。	尚無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		本公司已於公司網站設置利害關係人專區，並揭露利害關係人身份、關注議題、溝通管道、回應方式與特定聯絡窗口，以提供利害關係人溝通與檢舉申訴之管道。	尚無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司股務委任中國信託商業銀行代理部辦理股東會事務。	尚無重大差異。

項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、資訊公開				
1.公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形？	V		1.本公司已於公司網站(http://www.alchip.com)設中英文投資人關係專區揭露財務業務及公司治理資訊，也於公開資訊觀測站揭露相關資訊。	尚無重大差異。
2.公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		2.本公司已架設英文網站，設有專責人員負責資訊蒐集及揭露工作，包括法說會資訊等，並依規定設有發言人。	尚無重大差異。
3.公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		V	3.本公司目前未提前於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，但仍於規定期限內申報財務報告及營運情形。	本公司雖未提早公告並申報財務報告及營運情形，但公告申報期限均依規定辦理。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		1.本公司制定並執行符合政府勞工、福利及安全衛生法令之相關規定，保障員工權益並關懷僱員生活。 2.依公開發行公司相關法令規定揭露本公司營運及財務狀況供投資人瞭解，並妥善處理投資人各項詢問，以維持良好之投資人關係。 3.每年安排主管機關指定之訓練機構至本公司提供訓練課程予董事及獨立董事進修。 4.公司每年為董事及獨立董事購買責任保險，降低可能造成風險之損失。	尚無重大差異。

項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 1. 已改善情形： ● 本公司於2024年導入資訊安全管理系統ISO27001，並取得第三方驗證，以強化資通安全。 ● 本公司已制訂與營運目標連結之智慧財產管理計劃，以強化智財管理。 ● 本公司已制訂「關係人相互間之財務業務相關作業規範」。 ● 本公司已於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影檔至公司網站。 ● 本公司已設置提名委員會，其人數為3人(含2名獨立董事)，並由獨立董事擔任主席。 ● 本公司已投資 Shinhan Card Co.,Ltd. 社會責任債券(債券簡稱: P21SHC1 代碼: F17601) 美金20萬元。 ● 本公司自2024年起，已將永續發展策略與目標和高階經理人的激勵制度連結。 ● 本公司已制定董事會成員及重要管理階層之接班規劃。 ● 本公司已訂定董事會績效評估辦法經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次。已於2024年執行董事會外部評估作業。 ● 本公司已訂定人權政策。 ● 本公司依據 GRI 準則編製永續報告書，並經董事會通過。 2. 尚未改善者提出優先加強事項與措施： ● 本公司於2025年事會改選時，董事會成員會至少包含一名女性董事。 ● 本公司編製之永續報告書，預計取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。				

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：
本公司薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。

薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數	備註
獨立董事	洪茂蔚	本公司薪資報酬委員會由全體三位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本年第8-9頁	本公司薪資報酬委員會由全體三位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本年第8-9頁	請參閱本年第8-9頁	2	(註1)
獨立董事	江善頌				0	
獨立董事	莊彬甫				0	

註1：本委員會忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：2022年6月20日至2025年6月9日。薪酬委員會主席洪茂蔚先生於2024年度共召開2次常會，薪酬委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	洪茂蔚	2	0	100%	
委員	江善頌	2	0	100%	
委員	莊彬甫	2	0	100%	

其他應記載事項：

一、薪酬委員會之討論事由與決議結果

薪酬委員會日期	期別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
---------	----	-----------	------	---------------

2024年 3月1日	2024年 第1次	- 本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 - 本公司高階經理人2024年薪酬案。 - 本公司董事2024年每月報酬及業務執行費用案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2024年 8月23日	2024年 第2次	- 本公司追認2024年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。 - 本公司會計主管變動案。 - 本公司修訂「董事會績效考核辦法」案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形發生。

三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形發生。

(五) 提名委員會之組成、職責及運作情形：

本公司提名委員會於 2024 年 11 月 1 日設立，提名委員會成員為三人，由董事會決議委任之。委員會成員由獨立董事洪茂蔚先生、江善頌先生與董事 Shen, Johnny Shyang-Lin 先生組成。委員會之召集人洪茂蔚先生具財務會計、經營管理與領導決策等之專業資格。本公司提名委員會旨在尋覓、審核及提名董事會及高階經理人候選人，以及進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，及訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

2024 年度截至年報刊印日止，提名委員會共開會 1 次，委員會運作情形如下：

職稱	姓名	專長		實際出席次數	委託出席次數	出席率
召集人	洪茂蔚	財務會計、經營管理、領導決策		1	0	100%
委員	江善頌	經營管理、領導決策、產業經歷		1	0	100%
委員	Shen, Johnny Shyang Lin	經營管理、領導決策、產業經歷		1	0	100%

其他應記載事項：

日期	期別	議案內容	決議結果	公司對提名委員意見之處理
2024年11月1日	2024 年第 1 次	選任提名委員會之召集人及會議主席	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形。

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司於2024年11月成立永續發展委員會，負責推動公司永續經營，強化公司治理體質、實際環境保護及善盡企業社會責任。董事會授權由總經理擔任委員會主席，公司治理主管擔任召集人，並由研發、供應鏈管理、銷售、財務、財務及人力資源部門之高階主管擔任委員，並在轄下設置五個執行小組，分別為永續環境組、創新管理組、社會共好與友善職場組、夥伴共榮組及公司治理組，共同檢視永續發展工作執行情形，並依公司營運及外部利害關係人關切議題，訂定永續工作重點及目標。委員會至少每半年一次向董事會報告當年度執行成果及未來的工作計劃。董事會也會針對報告內容給予建議及檢視執行的成果，並在需要時督促委員會進行調整。	尚無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並透過檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門及子公司評估資料，據以評估具重大性之 ESG 議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。 (1) 環境面： • 環境衝擊及管理：持續宣導及進行節能減碳措施	尚無重大差異。

項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			施，達成降低二氧化碳排放目標。 (2) 社會面： - 職業安全:每年定期參與消防演練，宣導職業安全知識;定期進行員工健康檢查，降低員工之健康風險。 - 產品安全:每年定期進行客戶滿意度調查，強化客戶關係及提昇產品及服務品質。 (3) 公司治理 - 社會經濟與法令遵循:透過建立內部規範及落實內部控制機制，以確保公司所有人員能確實遵守相關法令規範。 - 強化董事職能: - 為董事規劃相關進修課程，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 - 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。 - 利害關係人溝通:設立利害關係人溝通窗口並妥適回應及處理利害關係人所關切之議題。另外，投資人相關議題，由發言人處理並負責回應。
三、環境議題			
1. 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度?	V		由於本公司並無工業之汙染，因此環境管理政策著重於員工日常環保節能減碳。
2. 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料?	V		本公司積極推動各項能源減碳措施，使用節能設備，提高能源使用之效率。
3. 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來	V		本公司已評估氣候變遷造成的潛在風險並採取相

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因				
	是	否	摘要說明					
來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？			對應的因應措施，詳細內容請參閱本公司之 2024 年永續報告書。					
4. 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		4. 本公司自 2022 年起即自主進行溫室氣體、用水量及廢棄物的盤查及管理，並依據 ISO 14064-1：2018 溫室氣體盤查的標準進行盤查並接受外部查證臺灣據點的溫室氣體排放量。詳細之節能減碳及溫室氣體減量執行情形、過去溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量及相關管理政策請參閱本公司之 2024 年永續報告書。	尚無重大差異。				
四、社會議題 1. 公司是否依照遵守相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		1. 本公司認同並自願遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國工商企業與人權指導原則」、「聯合國全球盟約」等國際公認之人權標準，制訂「世芯電子人權政策」，尊重人權公約所訂定之保障，並公布於本公司網站。本公司承諾遵循國際人權公約與基本勞動人權原則，落實性別平等、結社自由，禁止使用衝突礦產及關懷弱勢族群，並致力於消弭任何歧視、使用童工與強迫勞動行為，打造舒適的工作環境。本公司人權管理政策及具體方案摘要如下： <table><tr><td>人權管理政策</td><td>具體方案</td></tr><tr><td>提供安全與健康的 工作環境</td><td>請參閱永續報告書中勞資關係之 「工作環境與員工人身安全的保</td></tr></table>	人權管理政策	具體方案	提供安全與健康的 工作環境	請參閱永續報告書中勞資關係之 「工作環境與員工人身安全的保	尚無重大差異。
人權管理政策	具體方案							
提供安全與健康的 工作環境	請參閱永續報告書中勞資關係之 「工作環境與員工人身安全的保							

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因				
	是	否	摘要說明					
			<table><tr><td></td><td>護措施」相關說明。</td></tr><tr><td>禁止強迫勞動、恪遵當地政府勞動法令</td><td>落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡</td></tr></table>		護措施」相關說明。	禁止強迫勞動、恪遵當地政府勞動法令	落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡	
	護措施」相關說明。							
禁止強迫勞動、恪遵當地政府勞動法令	落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡							
2. 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		2. 本公司已訂立提供優於法令的薪資制度，包括固定薪資共十四個月、將經營績效反映在績效分紅。員工享有全面保險、完善的退休準備金制度，以及優於法定的休假制度，並依公司股利政策發放員工紅利。	尚無重大差異。				
3. 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		3. 本公司提供員工安全及健康之工作環境，並定期對員工進行健康檢查及工作環境安全教育，以預防職業災害，本公司於 2024 年度未發生火災以及職災之案例，將持續落實職安管理來預防事件發生。	尚無重大差異。				
4. 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		4. 本公司針對每位員工，依其工作屬性與專長，由部門主管負責其職涯規劃及相關訓練之執行。	尚無重大差異。				
5. 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準則？並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		5. 本公司對產品及服務之行銷及標示，係依照我國及客戶當地相關法規及國際標準則遵循。本公司品保單位設有「顧客滿意度及顧客抱怨程序書」以及在公司網站上設有利害關係人專區之申訴管道，以確保消費者權益。	尚無重大差異。				
6. 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		6. 本公司定期稽核供應商有無影響環保、職業安全衛生或勞動人權之紀錄，並將此紀錄納入供應商評估及稽核要項之一，若發現違反法規事項，本公司將提出警告並要求限期改善，情節嚴重者將	尚無重大差異。				

項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明
五、公司是否參考國際通用之報告書編製標準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		不再合作。 本公司依循全球報告倡議組織所發佈之永續性報導標準則 (GRI Standards)、臺灣證券交易所頒布之「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」與參考「氣候相關財務揭露建議(TCFD)」及永續會計準則委員會(SASB) 準則編製世芯電子永續報告書，並公佈永續報告書於公司網站 (https://www.alchip.com/tw/About_Alchip/esg)，目前尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已制訂「永續發展實務守則」，並依循此守則辦理相關事務。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）： 請參考本公司網站企業永續發展相關資訊，網址： https://www.alchip.com/tw/About_Alchip/esg			

氣候相關資訊

項次	項目	執行情形
I	敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	世芯電子重視氣候變遷對於營運變化的衝擊，目前由財務長暨發言人帶領財務及營運部門共同檢視氣候變遷對世芯電子的衝擊與影響。藉由專題會議，彙整氣候變遷議題，檢視各項議題對世芯電子產生之新興機會與風險衝擊。 世芯電子將於未來年度評估、規劃氣候變遷管理組織，並持續穩定地監控氣候變遷相關風險與機會以及檢視企業相關作為。 世芯於 2023 年 12 月設立溫室氣體盤查推行委員會，由永續長擔任高階主管，行政管理部擔任執行秘書，委員會轄下之盤查組員主則推動全公司環保、節能、節水及溫室氣體管理相關工作，並向永續發展委員會定期呈報計畫執行情形，再由永續發展委員會至少每半年一次向董事

		會報告當年度執行成果及未來工作計劃。
2	敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	為因應氣候變遷之議題，世芯電子目前已辨識出的氣候相關風險與機會包含： ● 短期：因極端氣候導致天然災害而影響公司營運；因能源不足或中斷導致營運成本提高； ● 中長期：因應氣候資訊揭露需進行溫室氣體盤查、確信，增加資訊揭露成本；徵收碳費、碳稅導致營運成本上升；提高綠電採購成本；或未能跟上低碳營運之轉型而影響公司營運。 為此制定的因應措施包含：辦公室緊急應變設備之設置、投保固定資產保險、節能減碳措施、擬定溫室氣體減量計畫及目標，以防止營運中斷、增加綠色營運效能並降低潛在之財務影響風險。 針對極端氣候事件，若天然災害規模大，可能會造成辦公室某些設備受損，或人員無法正常到班，影響公司正常營運。所以公司採取因應措施如下： ● 投保固定資產保險，以減緩因極端氣候異常可能對公司造成之損失，採用保險轉嫁風險及填補損失設置多個營運場所分散營運中斷風險。 ● 導入線上視訊系統，以降低因極端氣候異常人員無法正常到班時之影響。 ● 辦公大樓設置擋水閘門。 ● 定期舉辦災害教育訓練，並設置緊急應變之第二備援辦公室實地演練及災害復原演練計畫，確保因災害影響而造成營運中斷時可持續維持其業務之運作。 因此極端氣候事件及轉型行動與所採取的措施對財務的影響均極小。 世芯電子於2024年經董事會通過「風險管理政策」，以作為風險管理之最高指導原則。本公司每年定期評估風險，並由董事會與管理階層定期監督與檢討風險管理政策，將可能的風險進行風險辨識、風險評估分析，進而對高風險項目提出因應作法，把風險控制在可接受的範圍內，以達到公司穩健經營和永續發展的目標。 暫無相關規劃
3	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	世芯電子已建立水資源、溫室氣體排放等相關氣候風險及機會的管理指標。 水資源及溫室氣體排放量等分階段減量目標如下： ● 減碳目標： ➢ 短期：依2022年之碳排放強度為基準，目標每年減少碳排放強度1%。 ➢ 中期：於2030年達成減少碳排放強度8%。
4	敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	
5	若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	
6	若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	

		➤ 長期：以 2050 年達成碳排淨零為目標。 水資源減量目標：每年用水密集度比前一年度減少 0.25%；以 2022 年為基準年，2032 年用水密集度減少 10%。
7	若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	暫無相關規劃
8	若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵消或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵消之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	依法令規範時程進行溫室氣體排放盤查範疇一及範疇二，並定期檢討進度達成情形。目前尚未使用碳抵消以達成相關目標。 世芯電子於 2024 年的綠電使用量為 10,000 度,目前共有 10 張 T-REC。
9	溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	世芯電子 2024 年溫室氣體排放總量 344.8469 tCO₂e(地域別)/340.1069 tCO₂e(市場別)，其中直接排放(範疇一)為 3.8211 tCO₂e，皆為逸散排放源(冷媒、化糞池)，占整體排放量之 1.11%，因無生產製程，故無製程排放源；能源間接排放源(範疇二)為 230.7351 tCO₂e(地域別)/225.9951 tCO₂e(市場別)，主要來源為外購電力，占整體排放量之 66.91%(地域別)/66.45%(市場別)；其他間接排放源(範疇三與範疇四)分別為 60.6282 tCO₂e 與 49.6625 tCO₂e，占整體排放量之 31.98%。世芯最大宗之溫室氣體排放形式為 CO₂。 2022、2023 及 2024 年度之碳排放及用水數據皆業經外部單位確信。 依 2022 年之碳排放強度為基準，目標每年減少碳排放強度 1%，於 2030 年達成減少碳排放強度 8%並以 2050 年達成碳排淨零為目標。將每年審視溫室氣體排放情形及達成率，若有未達成之目標再進行檢討及修正。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。	
數據涵蓋範圍為世芯電子台灣營運據點	
年度	2023 (範疇一、二)
總溫室氣體排放量(公噸)	249.9480
	2024(範疇一、二、三、四)
	344.8469

年度營業收入(新台幣佰萬元)	30,481.58	51,968.57
溫室氣體排放強度	0.0082	0.0045

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。	
2022 年溫室氣體排放資訊 確信範圍：台北市內湖區文湖街 12 號 9 樓及新竹縣竹北市台元一街 1 號 11 樓之 1 及 3 樓之 3。 確信機構：財團法人台灣商品檢驗驗證中心。 確信準則：依據 ISO 14064-3:2019 完成查核並符合 ISO 14064-1:2018 標準要求。 確信意見：合理保證等級：類別 1：7.2432 tCO₂、類別 2：236.0606 tCO₂。 2023 年溫室氣體排放資訊 確信範圍：台北市內湖區文湖街 12 號 9 樓及新竹縣竹北市台元一街 1 號 11 樓之 1 及 3 樓之 3。 確信機構：財團法人台灣商品檢驗驗證中心。 確信準則：依據 ISO 14064-3:2019 完成查核並符合 ISO 14064-1:2018 標準要求。 確信意見：合理保證等級：類別 1：7.8648 tCO₂、類別 2：242.0832 tCO₂。	

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。	
- 節能減碳目標 短期目標：依 2022 年之碳排放強度為基準，目標每年減少碳排放強度 1%。 中期目標：於 2030 年達成減少碳排放強度 8%。長期目標：以 2050 年達成碳排淨零為目標。 - 策略及具體行動計畫：由於本公司並無工業污染，因此我們將著重於日常環保節能之宣導以達成環境保護及節能減碳之目的，相關措施如下： 1. 控制空調溫度於 24°C~26°C。 2. 宣導隨手關燈。 3. 提倡文件電子化及雙面用紙來減少紙張影印量及使用量。 4. 自 2024 年起全面使用電子發票來取代傳統紙本發票。 5. 股利通知電子化。 6. 提倡自備可重複使用之餐具以減少使用一次性塑料製品。 7. 定期宣導與執行員工垃圾分類與回收。	

8. 持續宣導節電與節水措施，提醒員工節約能源。
達成情形說明：世芯透過積極的宣導節能減碳，2024 年度溫室氣體排放強度較 2022 年減少 74.30%。

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供建立良好商業運作，已制訂「誠信經營作業程序及行為指南」，並依循辦理相關事務。

項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 1.公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層承諾積極落實經營政策之承諾？ 2.公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ 3.公司是否於防範不誠信行為方案並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正揭方案？	V	V	1.本公司業依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露本公司誠信經營政策。 2.本公司目前尚未建立不誠信行為風險之評估機制，但已於「誠信經營作業程序及行為指南」中訂定防範措施。 3.本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」中明確規範「禁止提供或收受不正當利益」、「禁止疏通費」、「禁止提供非法政治現金」、「禁止不當慈善捐贈或贊助」。為塑造高度誠信經營理念，本公司定期舉辦教育訓練課程，提升同仁誠信及自律觀念，以落實執行。為確保本公司的行為符合法規與從業道德規範的要求，針對不誠信行為，公司提供了舉報管道。	尚無重大差異。 本公司尚未建立不誠信行為風險之評估機制。 尚無重大差異。

項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			若有本公司人員違反誠信行為情節重大者，依相關法令或公司人事辦法予以解任或解雇，如造成公司名譽及權益損害，必要時透過法律程序請求損害賠償。	
二、落實誠信經營 1.公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		1.本公司與他人建立商業關係前，均先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄。另，本公司與他人簽訂契約時，均充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款。	尚無重大差異。
2. 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		2.本公司人力資源部門為企業誠信經營專責單位，負責「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」辦法之修訂及監督執行，並每年至少一次向董事會報告誠信經營執行成果。 本公司積極推動誠信經營政策及落實成效，除定期檢視法規的變動，也落實法令及執行誠信經營政策，公司定期對同仁進行教育訓練及法遵宣導。 2024年相關執行成效如下： • 貪腐情事及反競爭行為：0件 • 受理外部檢舉案件:0件 • 員工直接檢舉:0件	尚無重大差異。
3.公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		3.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」明確要求董事對董事會所列議案有利害關係者，得陳述意見及答詢，討論及表決時應予以迴避；本公司同仁於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，須將相關情事同	尚無重大差異。

項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
4.公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		時陳報直屬主管及本公司稽核部，且直屬主管應提供適當指導。 4.本公司會計制度係參照公司法、證券交易法、證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋、解釋公告等相關法令規定，並依本公司業務實際情形訂定；內部控制係參照公開發行公司建立內控控制制度處理準則訂定，均落實執行。內部稽核單位擬訂年度稽核計劃進行各項稽核，並呈報董事會及管理階層稽核結果與後續改善方案，以落實稽核成效。另外，本公司每年執行內控自評作業，要求各部門及子公司均須自我檢視內部控制制度設計及執行之有效性。 5.本公司定期對員工進行誠信經營之宣導及教育訓練。 2024年訓練成果：誠信經營宣導課程訓練時數合計60人時。	尚無重大差異。
5.公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V			尚無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 1.公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		1.本公司已訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」說明檢舉管道及受理專責人員，若員工或外部人士檢舉人可透過「親身舉報」、「電話舉報」、「投函舉報」向受理單位檢舉，亦可透過本公司網站設置檢舉信箱，逕行檢舉。檢舉管道如下： • 股東、投資人等利害關係人：IR@alchip.com • 董事、客戶、供應商：whistleblower@alchip.com • 員工：hr@alchip.com	尚無重大差異。

項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
2.公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制?	V		2.本公司已訂定檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法說明處理程序及相關保密機制，以保護當事人資料及隱私。	尚無重大差異。
3.公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?	V		3.本公司針對提出檢舉的人員皆採保密機制，禁止揭露任何檢舉人之相關資料，以保護檢舉人不因檢舉不法而受到處置。	尚無重大差異。
四、加強資訊揭露 1.公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?	V		本公司已於網站(http://www.alchip.com)揭露誠信經營守則及辦理教育訓練宣導。	尚無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：詳上述各欄。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之規範，以提升本公司誠信經營之成效。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(九) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：詳第 53 頁。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事會及股東會之重要決議：

董事會決議事項：

1. 2024 年 3 月 1 日(2024 年第 1 次)董事會重要決議如下：

案由一：核認本公司 2023 年度合併財務報表案。

案由二：核認本公司 2023 年度盈餘分配案。

案由三：核認本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

案由四：核認本公司 2023 年度營業報告書案。

案由五：核認本公司 2023 年度內部控制聲明書。

案由六：通過本公司高階經理人 2024 年薪酬案。

案由七：通過本公司董事 2024 年每月報酬及業務執行費用案。

案由八：通過本公司參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性案。

案由九：通過本公司以 Alchip Investment, Inc.投資 Adoresys Pte. Ltd.案。

案由十：通過本公司 2023 年度第一次員工認股權憑證發行及授予名冊案。

案由十一：通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」與「股東會議事規則」案。

案由十二：通過解除董事競業禁止之限制案。

案由十三：通過本公司 2024 年股東常會會議召集日期、地點、停止過戶期間及召集事由案。

案由十四：通過 2024 年股東常會受理持股百分之一以上股東提案之受理期間及受理處所。

2. 2024 年 4 月 16 日(2024 年第 2 次)董事會重要決議如下：

案由一：通過本公司成立越南子公司案。

案由二：通過本公司辦理私募普通股案。

案由三：通過解除董事競業禁止之限制案。

案由四：通過本公司 2024 年股東常會會議召集日期、地點、停止過戶期間及召集事由案。

3. 2024 年 5 月 3 日(2024 年第 3 次)董事會重要決議如下：

案由一：核認本公司 2024 年第一季合併財務報表案。

案由二：通過本公司於國泰世華商業銀行國際金融業務分行及花旗(台灣)商業銀行國際金融業務分行開立存款帳戶案。

案由三：通過本公司 BVI 子公司增資案。

案由四：通過本公司發行 2024 年員工認股權憑證案。

4. 2024 年 5 月 14 日(2024 年第 1 次)臨時董事會重要決議如下：

案由一：通過本公司私募普通股現金增資洽定應募人及訂定增資基準日案。

案由二：通過本公司 112 年股東常會決議辦理之私募普通股案擬不繼續辦理募集發行案。

5. 2024 年 8 月 23 日(2024 年第 4 次)董事會重要決議如下：
- 案由一：核認本公司 2024 年第二季合併財務報表案。
 - 案由二：通過訂定本公司配發現金股利基準日等相關作業事宜。
 - 案由三：通過本公司會計主管變動案。
 - 案由四：通過本公司 2023 永續報告書案。
 - 案由五：通過本公司訂定「人權政策」、修訂「董事會績效評估辦法」與「誠信經營作業程序及行為指南」案。
 - 案由六：通過本公司追認 2024 年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。
 - 案由七：通過本公司 2024 年度第一次員工認股權憑證發行及授予名冊案。
6. 2024 年 11 月 1 日(2024 年第 5 次)董事會重要決議如下：
- 案由一：核認本公司 2024 年第三季財務報表案。
 - 案由二：通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任案。
 - 案由三：通過本公司 2025 年稽核計畫案。
 - 案由四：通過本公司訂定「提名委員會組織規程」，並成立提名委員會案。
 - 案由五：通過本公司第一屆提名委員會委員之委任案。
 - 案由六：通過本公司訂定「永續發展委員會組織規程」，並成立永續發展委員會案。
 - 案由七：通過本公司增訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」、「風險管理政策」、「內部控制制度及內稽實施細則-永續資訊之管理」與「誠信經營實務守則」案。
 - 案由八：通過本公司修訂「公司治理實務守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」案。
 - 案由九：通過本公司 2024 年度第二次員工認股權憑證發行及授予名冊案。
 - 案由十：通過本公司私募普通股現金增資洽定應募人及訂定增資基準日案。
7. 2025 年 2 月 27 日(2025 年第 1 次)董事會重要決議如下：
- 案由一：核認本公司 2024 年度合併財務報表案。
 - 案由二：核認本公司 2024 年度盈餘分配案。
 - 案由三：核認本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
 - 案由四：核認本公司 2024 年度營業報告書案。
 - 案由五：核認本公司 2024 年度內部控制聲明書。
 - 案由六：通過本公司高階經理人 2025 年薪酬案。
 - 案由七：通過本公司董事 2025 年每月報酬及業務執行費用案。
 - 案由八：通過勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。
 - 案由九：通過本公司參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性案。
 - 案由十：通過本公司訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案。
 - 案由十一：通過本公司修訂「公司章程」案。
 - 案由十二：通過本公司修訂「公司治理實務守則」與「審計委員會組織規程」案。
 - 案由十三：通過全面改選董事(含獨立董事)案。
 - 案由十四：通過新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案。
 - 案由十五：通過本公司 2025 年股東常會會議召集日期、地點、停止過戶期間及召集事由案。

案由十六：通過 2024 年股東常會受理持股百分之一以上股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之受理期間及受理處所。

股東會決議事項及執行情形：

1. 2024 年 5 月 30 日股東常會：

項次	決議事項	執行情形
案由一	承認本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案	決議通過。
案由二	承認本公司民國 112 年度盈餘分配案	1.民國 112 年盈餘分配，股東配發現金股利美金 56,300,842 元。 2.訂定民國 113 年 9 月 20 日為配息基準日，於民國 113 年 10 月 16 日發放完畢。
案由三	修訂股東會議事規則案	業依修訂後之辦法辦理。
案由四	解除董事競業禁止案	決議通過。
案由五	本公司辦理私募普通股案	決議通過。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止董事及獨立董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

五、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	王儀雯	2024 年	7,065	630	7,695	
	張麗君					

註：非審計公費為年度營利事業所得稅稅務簽證費。

公司有下列情事之一者，應揭露下列事項：

- (一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
- (二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

六、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	2025 年 2 月 27 日董事會通過		
更換原因及說明	基於相關法令規定會計師輪調的必要，本公司自 2025 年起主辦會計師將由王儀雯會計師更換為劉建良會計師，會簽會計師將繼續由張麗君會計師擔任。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用

最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	P	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所		
會計師姓名	劉建良會計師、張麗君會計師		
委任之日期	2025 年 2 月 27 日董事會通過		
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無		
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無		

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師事務所或關係企業：無。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓 名	2024 年度		2025 年截至 3 月 31 日止	
		持有股數 增（減）數	質押股數 增（減）數	持有股數 增（減）數	質押股數 增（減）數
董事長	關建英	(5,000)	0	(8,000)	0
董事	張國威	0	0	0	0
董事/執行長	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	200,000	0	0	0

職稱	姓 名	2024 年度		2025 年截至 3 月 31 日止	
		持 有 股 數 增（減）數	質 押 股 數 增（減）數	持 有 股 數 增（減）數	質 押 股 數 增（減）數
董事/財務長	王德善	200,000 (200,000)	0	0	0
獨立董事	洪茂蔚	0	0	0	0
獨立董事	江善頌	0	0	0	0
獨立董事	莊彬甫	0	0	0	0
副總經理	林志堅	169,000	0	0	0
副總經理	古園 博幸 Furuzono, Hiroyuki	0	0	0	0
資深副總經理	黃耀林	150,000	220,000 (100,000)	0	0
資深副總經理	鄭永力	269,187 (97,000)	0	(2,000)	0
副總經理	張政淵	112,500	0	0	0
副總經理	鄧建成	66,041	30,000	0	0
會計主管	金曉煒(註 1)	0	0	0	0
會計主管	詹舒媚(註 2)	0	0	0	0

註 1：金曉煒女士於 2024 年 9 月 1 日卸任會計主管。

註 2：詹舒媚女士於 2024 年 9 月 1 日新任會計主管。

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊：

姓名	股權移轉 原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司董 事、監察人、經理人 及持股比例超過百分 之十股東之關係	股數	交易價格
王德善	贈與	2024/10/21	張慧	夫妻	115,000	1,925
王德善	贈與	2024/12/31	張慧	夫妻	85,000	2,560

(三) 股權質押之相對人為關係人資訊：無。

九、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊：

單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
花旗託管新加坡政府－G O S－E F M C	2,564,790	3.17%	0	0	0	0	-	-	
渣打託管渣打香港－外部管理者摩根大通	1,929,000	2.39%	0	0	0	0	-	-	
Shen, Johnny Shyang-Lin(沈翔霖)	1,721,652	2.13%	0	0	0	0	-	-	
國泰人壽	1,606,000	1.99%	0	0	0	0	-	-	
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	1,509,345	1.87%	0	0	0	0	-	-	
花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	1,282,204	1.59%	0	0	0	0	-	-	
大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	1,091,520	1.35%	0	0	0	0	-	-	
花旗託管全國金融服務有限公司投資專戶	1,078,908	1.33%	0	0	0	0	-	-	
花旗託管科威特委外東方匯理資產管理香港	1,076,068	1.33%	0	0	0	0	-	-	
新制勞工退休基金	1,044,000	1.29%	0	0	0	0	-	-	

十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

2024 年 12 月 31 日 單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
香港世芯電子	14,165,970,100	100	-	-	14,165,970,100	100
美國世芯電子	391,000,000	100	-	-	391,000,000	100
日本世芯電子	1,000	100	-	-	1,000	100
臺灣世芯電子	10,000	100	-	-	10,000	100
Alchip BVI	50,000	100	-	-	50,000	100
上海世芯電子	(註 1)	100	-	-	(註 1)	100
無錫世芯電子	(註 1)	100	-	-	(註 1)	100
合肥捷芯科技	(註 1)	100	-	-	(註 1)	100
濟南世芯電子	(註 1)	100	-	-	(註 1)	100
廣州世芯電子	(註 1)	100	-	-	(註 1)	100
重慶世芯電子	(註 1)	100	-	-	(註 1)	100
矽雲(上海)科技	(註 1)	65	-	-	(註 1)	65
馬來西亞世芯電子	4,681,010	100	-	-	4,681,010	100
越南世芯電子	(註 1)	100			(註 1)	100

註 1：係有限公司，故未發行股份。

Alchip Technologies, Limited

內部控制制度聲明書

日期：2025 年 2 月 27 日

本公司 2024 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於2024年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司2025年2月27日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

Alchip Technologies, Limited
(英屬開曼群島商世芯電子
股份有限公司)



董事長：關建英 簽章



總經理：沈翔霖 簽章



參、募資情形

一、資本及股份、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證及併購（包括合併、收購及分割）之辦理情形

（一）股本來源：

單位：股/金額除另有註明外，係新臺幣元

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
2010.07	10	100,000,000	1,000,000,000	52,420,842	523,364,710	資本公積 轉增資	無	-
2010.07	10	100,000,000	1,000,000,000	53,871,342	538,713,420	行使認股權 發行新股	無	-
2013.11	10	100,000,000	1,000,000,000	53,947,342	539,473,420	行使認股權 發行新股	無	-
2014.10	10	100,000,000	1,000,000,000	61,628,342	616,283,420	現金增資 發行新股	無	-
2014.01-12	10	100,000,000	1,000,000,000	63,481,815	634,818,150	行使認股權 發行新股	無	-
2015.01-03	10	100,000,000	1,000,000,000	63,766,815	637,668,150	行使認股權 發行新股	無	-
2015.08	10	100,000,000	1,000,000,000	61,567,815	615,678,150	註銷庫藏股	無	-
2016.11	10	100,000,000	1,000,000,000	60,702,815	607,028,150	註銷庫藏股	無	-
2017.07-12	10	100,000,000	1,000,000,000	61,001,038	610,010,380	行使認股權 發行新股	無	-
2018.01-11	10	100,000,000	1,000,000,000	61,698,098	616,980,980	行使認股權 發行新股	無	-
2018.12	10	100,000,000	1,000,000,000	59,773,098	597,730,980	註銷庫藏股	無	-
2019.01-12	10	100,000,000	1,000,000,000	60,612,932	606,129,320	行使認股權 發行新股	無	-
2020.01-12	10	100,000,000	1,000,000,000	62,028,463	620,284,630	行使認股權發 行新股	無	-
2021.01	10	100,000,000	1,000,000,000	69,628,463	696,284,630	現金增資 發行新股	無	-
2021.10	10	100,000,000	1,000,000,000	69,206,463	692,064,630	註銷庫藏股	無	-
2021.01-12	10	100,000,000	1,000,000,000	70,687,604	706,876,040	行使認股權發 行新股	無	-
2022.01-12	10	100,000,000	1,000,000,000	71,928,014	719,280,140	行使認股權發 行新股	無	-
2023.07	10	100,000,000	1,000,000,000	73,308,014	733,080,140	私募現金增資 發行新股	無	-
2023.01-12	10	100,000,000	1,000,000,000	74,318,728	743,187,280	行使認股權發 行新股	無	-

2024.01	10	100,000,000	1,000,000,000	78,018,728	780,187,280	現金增資 發行新股	無	-
2024.05	10	100,000,000	1,000,000,000	78,243,265	782,432,650	私募現金增資 發行新股	無	-
2024.11	10	100,000,000	1,000,000,000	78,843,265	788,432,650	私募現金增資 發行新股	無	-
2024.01-12	10	100,000,000	1,000,000,000	80,648,548	806,485,480	行使認股權發 行新股	無	-
2025.01-03	10	100,000,000	1,000,000,000	80,855,695	808,556,950	行使認股權發 行新股	無	-

2025 年 3 月 31 日；單位：股

股份種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	80,855,695	19,144,305	100,000,000	

總括申報制度募集發行有價證券之情形：無此情事。

- (二) 主要股東名單：列明持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

2025年3月31日；單位：股

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例
花旗託管新加坡政府－G O S－E F M C	2,564,790	3.17%
渣打託管渣打香港－外部管理者摩根大通	1,929,000	2.39%
Shen, Johnny Shyang-Lin(沈翔霖)	1,721,652	2.13%
國泰人壽	1,606,000	1.99%
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	1,509,345	1.87%
花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	1,282,204	1.59%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	1,091,520	1.35%
花旗託管全國金融服務有限公司投資專戶	1,078,908	1.33%
花旗託管科威特委外東方匯理資產管理香港	1,076,068	1.33%
新制勞工退休基金	1,044,000	1.29%

- (三) 公司股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策

- (1) 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥當年度獲利不低於 1% 為員工酬勞及不高於 2% 為董事酬勞。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前開員工酬勞得以股票或現金為之，且得按照第 11.1 條規定同意之員工激勵計畫配發。員工酬勞發給之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股

東會。董事兼任公司及/或其從屬公司之執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任員工之酬勞。

- (2) 本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，本公司之股利政策將依據本公司未來資金支出預算及資金需求情形，以現金股利及/或股份以代替現金股利方式配發予本公司股東。本公司得依董事會擬訂並經股東會以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤。董事會應以下述方式擬訂該利潤分配計畫：本公司應依法提撥應繳納之稅款並就年度淨利先彌補歷年虧損，並依公開發行公司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積。任何所餘利潤除法令及公開發行公司法令另有規定外，公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之期待，就可分配盈餘擬定利潤分配計畫，提報股東會決議，盈餘之分派得以現金股利或股票股利（盈餘轉增資按比例分配股份予股東）之方式為之，股利總額至少應為當年度盈餘扣除上述規定之百分之十（10%），其中現金股利發放總額不得低於發放股東股利總額之 10%，最高以 100%為上限。
- (3) 在不違反法令、章程及公開發行公司法令的情形下，董事會得公告股利和每股盈餘，並以公司於法律上可動用的資金支付股利或利益分派。除以公司已實現或未實現利益、股份發行溢價金額或法令允許的其他款項支付股利或為利潤分派外，不得支付股利或為利潤分派。
- (4) 除另有相關約定外，應根據股東持股比例分派股利。如果股份發行的條件是從某一特定日期開始計算股利，則該股份之股利應依此計算。
- (5) 股東如應向公司支付款項，董事會得從應支付予該股東的股利或利潤分派中扣除之。
- (6) 董事會於經股東會之普通決議通過後，得宣佈以特定資產作為全部或部分股利之分派（特別是其他公司之股份、債券或證券），或以其中一種或多種方式支付，如分配發生困難時，董事會得以適當、有效率的方式解決，並確定就特定資產分配之價值或其一部之價值，且得決定依所確定價值向股東支付現金以調整股東的權利；如董事會認為適當有效率者，得就上述特定資產設立信託。
- (7) 任何股利、分派、利息或與股份有關的其他現金支付，得匯款轉帳給股東，或以支票或認股憑證郵寄到股東的登記地址。每一支票或認股憑證應依收件人的指示支付。
- (8) 任何股利或分派不得向公司要求加計利息。
- (9) 不能支付予股東的股利及/或在股利公告日起六個月後仍無人主張的股利，得依董事會的決定，支付到以公司名義開立的獨立帳戶，但公司不得成為該帳戶的受託人，且該股利仍為應支付給股東的債務。如於股利公告日起六年之後仍無人請求的股利，將被認定為股東已拋棄其得請求之權利，該股利並轉歸公司所有。

2. 本次股東會擬議股利分配情形

本公司本次盈餘分派擬自 2024 年度可分配盈餘中提撥美金 98,569,525 元(每股 1.22137 元)為股東股利，股東股利全數以發放現金方式為之。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工酬勞及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司係以當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以不低於 1%及不高於 2%提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基

礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司 2024 年度員工及董事酬勞估列金額分別為美金 10,000,000 元及 1,500,000 元，係分別以扣除員工及董事酬勞前之稅前利益 3.93%及 0.59%估算。若實際分配金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，於分配年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額，若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司董事會通過分派之員工酬勞全數以現金發放，故比例皆為 0。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 2023 年度配發員工及董事酬勞，實際配發情形與估列並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：

截至年報刊印日 2025 年 3 月 31 日止，公司買回本公司股份情況如下表：

買回期次	第 1 次 (期)	第 2 次 (期)	第 3 次 (期)	第 4 次 (期)	第 5 次 (期)	第 6 次 (期)
買回目的	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益
買回期間	2015 年 3 月 16 日至 2015 年 5 月 5 日	2015 年 5 月 15 日至 2015 年 6 月 12 日	2016 年 8 月 26 日至 2016 年 9 月 26 日	2017 年 3 月 13 日至 2017 年 5 月 9 日	2018 年 9 月 12 日至 2018 年 10 月 30 日	2021 年 5 月 12 日至 2021 年 7 月 6 日
買回區間價格	50.05 元至 123.82 元	35.91 元至 87.58 元	19.01 元~41.21 元	28.88 元~57.54 元	64.26 元~167.94 元	280 元~720 元
已買回股份種類及數量	普通股 1,015 仟股	普通股 1,184 仟股	普通股 865 仟股	普通股 0 仟股	普通股 1,925 仟股	普通股 422 仟股
已買回股份金額	新臺幣 60,917,192 元	新臺幣 52,462,561 元	新臺幣 21,692,815 元	新臺幣 0 元	新臺幣 157,947,222 元	新臺幣 206,571,586 元
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	50.75%	59.20%	86.50%	0%	96.25%	42.20%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 1,015 仟股	普通股 1,184 仟股	普通股 865 仟股	普通股 0 仟股	普通股 1,925 仟股	普通股 422 仟股
累積持有本公司股份數量	普通股 0 股	普通股 0 股	普通股 0 股	普通股 0 股	普通股 0 股	普通股 0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(七) 公司債辦理情形：本公司截至年報刊印日止無辦理公司債（含海外公司債）。

(八) 特別股辦理情形：不適用。

(九) 海外存託憑證辦理情形：

發行(辦理)日期			2021 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 19 日
項目				
發行及交易地點			盧森堡證券交易所	
發行總金額			美金 195,548,000 元	美金 412,661,000 元
單位發行價格			美金 25.73 元	美金 111.53 元
發行單位總數			7,600,000 單位	3,700,000 單位
表彰有價證券之來源			現金增資發行新股	
表彰有價證券之數額			每單位存託憑證表彰本公司普通股 1 股	
存託憑證持有人之權利與義務			權利義務與普通股相同	
受託人			無	
存託機構			花旗銀行	
保管機構			花旗(臺灣)銀行	
未兌回餘額			在外流通總數為 116,629 單位。	
發行及存續期間相關費用之分攤方式			由發行公司負擔	
存託契約及保管契約之重要約定事項			詳存託契約及保管契約	
每單位市價 (US\$)	當年度截至 2025 年 3 月 31 日	最高	141	
		最低	57.50	
		平均	89.63	

(十) 員工認股權證辦理情形：

1. 公司尚未屆期之員工認股權憑證

2025 年 3 月 31 日

員工認股權憑證種類	2015 年員工認股權憑證		2016 年員工認股權憑證	
申報生效日期	2015 年 3 月 30 日		2016 年 4 月 26 日	
總單位數(註 1)	2,000		2,000	
發行日期	2015 年 4 月 24 日	2016 年 3 月 4 日	2016 年 11 月 11 日	2017 年 3 月 10 日
已發行股數	864,000	1,136,000	1,200,000	800,000
尚可發行股數	0		0	
發行得認購股數占已發行股份總數比率	1.09%	1.40%	1.48%	0.99%
認股存續期間	認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿 10 年後~存續期間屆滿		認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿 10 年後~存續期間屆滿	
履約方式	發行新股		發行新股	
限制認股期間及比率(%)	屆滿二年得執行 50%，其後每月既得四十八分之一之認股權		屆滿二年得執行 50%，其後每月既得四十八分之一之認股權	
已執行取得股數	809,000	940,494	942,000	603,750
已執行認股金額(新臺幣)	44,656,800	34,139,932	22,984,800	24,150,000
未執行認股數量	0	8,000	33,000	18,000
未執行認股者其每股認購價格(新臺幣)	55.20	36.30	24.40	40.00
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0.00%	0.01%	0.04%	0.02%
失效之股數(註 2)	55,000	187,506	225,000	178,250
對股東權益影響	於財務報表表達上，依國際會計原則處理，惟本公司之認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿二年之日起，可行使被給予 50%之認股權，其後每月既得四十八分之一之認股權，對原股東權益之影響係逐年稀釋。			

註 1：每一單位為 1,000 股。

註 2：因員工離職而失效與員工認股權憑證到期之股數。

員工認股權憑證 種類	2017 年員工認股權憑證					
申報生效日期	2017 年 4 月 25 日					
總單位數(註 1)	2,000					
發行日期	2017 年 11 月 28 日	2017 年 12 月 5 日	2018 年 1 月 5 日	2018 年 2 月 7 日	2018 年 3 月 30 日	2018 年 4 月 18 日
已發行股數	330,000	500,000	329,000	95,000	250,000	200,000
尚可發行股數	0					
發行得認購股數 占已發行股份總 數比率	0.41%	0.62%	0.41%	0.12%	0.31%	0.25%
認股存續期間	認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿 10 年後~存續期間屆滿					
履約方式	發行新股					
限制認股期間及 比率(%)	屆滿二年得執行 50%，其後每月既得四十八分之一之認股權					
已執行取得股數	291,000	420,000	255,700	62,000	197,250	165,475
已執行認股金額 (新臺幣)	23,629,200	31,458,000	24,393,780	5,772,200	22,644,300	19,956,285
未執行認股數量	19,000	0	7,300	8,000	29,000	6,150
未執行認股者其 每股認購價格 (新臺幣)	81.20	74.90	95.40	93.10	114.80	120.60
未執行認股數量 占已發行股份總 數比率(%)	0.02%	0.00%	0.01%	0.01%	0.04%	0.01%
失效之股數(註 2)	20,000	80,000	66,000	25,000	23,750	28,375
對股東權益影響	於財務報表表達上，依國際會計原則處理，惟本公司之認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿二年之日起，可行使被給予 50% 之認股權，其後每月既得四十八分之一之認股權，對原股東權益之影響係逐年稀釋。					

註 1：每一單位為 1,000 股。

註 2：因員工離職而失效與員工認股權憑證到期之股數。

員工認股權憑證 種類	2018 年員工認股權憑證			
申報生效日期	2018 年 5 月 21 日			
總單位數(註 1)	2,000			
發行日期	2018 年 8 月 10 日	2018 年 9 月 20 日	2019 年 3 月 19 日	2019 年 5 月 20 日
已發行股數	500,000	500,000	500,000	500,000
尚可發行股數	0			
發行得認購股數 占已發行股份總 數比率	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%
認股存續期間	認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿 10 年後~存續期間屆滿			
履約方式	發行新股			
限制認股期間及 比率(%)	屆滿二年得執行 50%，其後每月既得四十八分之一之認股權			
已執行取得股數	452,500	373,287	452,500	369,999
已執行認股金額 (新臺幣)	53,666,500	31,878,710	33,168,250	26,861,927
未執行認股數量	2,500	58,563	8,000	79,438
未執行認股者其 每股認購價格 (新臺幣)	118.60	85.40	73.30	72.60
未執行認股數量 占已發行股份總 數比率(%)	0.00%	0.07%	0.01%	0.10%
失效之股數 (註 2)	45,000	68,150	39,500	50,563
對股東權益影響	於財務報表表達上，依國際會計原則處理，惟本公司之認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿二年之日起，可行使被給予 50% 之認股權，其後每月既得四十八分之一之認股權，對原股東權益之影響係逐年稀釋。			

註 1：每一單位為 1,000 股。

註 2：因員工離職而失效與員工認股權憑證到期之股數。

員工認股權憑證 種類	2019 年員工認股權憑證				
申報生效日期	2019 年 5 月 21 日				
總單位數(註 1)	1,000				
發行日期	2019 年 8 月 7 日	2019 年 11 月 7 日	2019 年 11 月 22 日	2020 年 2 月 18 日	2020 年 4 月 28 日
已發行股數	500,000	40,000	160,000	150,000	150,000
尚可發行股數	0				
發行得認購股數 占已發行股份總 數比率	0.62%	0.05%	0.20%	0.19%	0.19%
認股存續期間	認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿 10 年後~存續期間屆滿				
履約方式	發行新股				
限制認股期間及 比率(%)	屆滿二年得執行 50%，其後每月既得四十八分之一之認股權				
已執行取得股數	441,708	20,000	115,166	75,250	85,829
已執行認股金額 (新臺幣)	41,255,527	3,620,000	23,136,849	15,268,225	22,530,113
未執行認股數量	41,000	0	16,000	63,750	47,710
未執行認股者其 每股認購價格 (新臺幣)	93.40	181.00	200.90	202.90	262.50
未執行認股數量 占已發行股份總 數比率(%)	0.05%	0.00%	0.02%	0.08%	0.06%
失效之股數 (註 2)	17,292	20,000	28,834	11,000	16,461
對股東權益影響	於財務報表表達上，依國際會計原則處理，惟本公司之認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿二年之日起，可行使被給予 50%之認股權，其後每月既得四十八分之一之認股權，對原股東權益之影響係逐年稀釋。				

註 1：每一單位為 1,000 股。

註 2：因員工離職而失效與員工認股權憑證到期之股數。

員工認股權憑證 種類	2020 年員工認股權憑證			
申報生效日期	2020 年 4 月 28 日			
總單位數(註 1)	2,000			
發行日期	2020 年 6 月 15 日	2020 年 7 月 31 日	2020 年 12 月 15 日	2021 年 3 月 8 日
已發行股數	400,000	200,000	800,000	600,000
尚可發行股數	0			
發行得認購股數 占已發行股份總 數比率	0.49%	0.25%	0.99%	0.74%
認股存續期間	認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿 10 年後~存續期間屆滿			
履約方式	發行新股			
限制認股期間及 比率(%)	屆滿二年得執行 50%，其後每月既得四十八分之一之認股權			
已執行取得股數	344,728	102,583	337,795	163,499
已執行認股金額 (新臺幣)	110,002,705	57,272,089	186,192,604	129,311,359
未執行認股數量	55,272	34,000	236,620	379,313
未執行認股者其 每股認購價格 (新臺幣)	319.10	558.30	551.20	790.90
未執行認股數量 占已發行股份總 數比率(%)	0.07%	0.04%	0.29%	0.47%
失效之股數 (註 2)	0	63,417	225,585	57,188
對股東權益影響	於財務報表表達上，依國際會計原則處理，惟本公司之認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿二年之日起，可行使被給予 50%之認股權，其後每月既得四十八分之一之認股權，對原股東權益之影響係逐年稀釋。			

註 1：每一單位為 1,000 股。

註 2：因員工離職而失效與員工認股權憑證到期之股數。

員工認股權憑證 種類	2021 年員工認股權憑證				
申報生效日期	2021 年 5 月 5 日				
總單位數(註 1)	1,500				
發行日期	2021 年 5 月 17 日	2021 年 8 月 20 日	2021 年 10 月 29 日	2022 年 3 月 9 日	2022 年 4 月 29 日
已發行股數	800,000	50,000	50,000	200,000	200,000
尚可發行股數	0				
發行得認購股數 占已發行股份總 數比率	0.99%	0.06%	0.06%	0.25%	0.25%
認股存續期間	認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿 10 年後~存續期間屆滿				
履約方式	發行新股				
限制認股期間及 比率(%)	屆滿二年得執行 50%，其後每月既得四十八分之一之認股權				
已執行取得股數	233,952	10,333	19,832	45,561	51,499
已執行認股金額 (新臺幣)	92,738,573	5,769,947	19,683,260	43,155,379	43,969,846
未執行認股數量	429,776	26,667	20,168	121,834	92,501
未執行認股者其 每股認購價格 (新臺幣)	396.40	558.40	992.50	947.20	853.80
未執行認股數量 占已發行股份總 數比率(%)	0.53%	0.03%	0.02%	0.15%	0.11%
失效之股數 (註 2)	136,272	13,000	10,000	32,605	56,000
對股東權益影響	於財務報表表達上，依國際會計原則處理，惟本公司之認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿二年之日起，可行使被給予 50%之認股權，其後每月既得四十八分之一之認股權，對原股東權益之影響係逐年稀釋。				

註 1：每一單位為 1,000 股。

註 2：因員工離職而失效與員工認股權憑證到期之股數。

員工認股權憑證 種類	2022 年員工認股權憑證		
申報生效日期	2022 年 5 月 23 日		
總單位數(註 1)	800		
發行日期	2022 年 8 月 26 日	2022 年 11 月 15 日	2023 年 5 月 22 日
已發行股數	200,000	100,000	125,000
尚可發行股數	0		
發行得認購股數 占已發行股份總 數比率	0.25%	0.12%	0.15%
認股存續期間	認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿 10 年後~存續期間屆滿		
履約方式	發行新股		
限制認股期間及 比率(%)	屆滿二年得執行 50%，其後每月既得四十八分之一之認股權		
已執行取得股數	16,562	11,333	0
已執行認股金額 (新臺幣)	13,214,820	9,336,125	0
未執行認股數量	158,438	88,667	84,000
未執行認股者其 每股認購價格 (新臺幣)	797.90	823.80	1,490.20
未執行認股數量 占已發行股份總 數比率(%)	0.20%	0.11%	0.10%
失效之股數 (註 2)	25,000	0	41,000
對股東權益影響	於財務報表表達上，依國際會計原則處理，惟本公司之認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿二年之日起，可行使被給予 50%之認股權，其後每月既得四十八分之一之認股權，對原股東權益之影響係逐年稀釋。		

註 1：每一單位為 1,000 股。

註 2：因員工離職而失效與員工認股權憑證到期之股數。

員工認股權憑證種類	2023 年員工認股權憑證	2024 年員工認股權憑證	
申報生效日期	2023 年 5 月 23 日	2024 年 5 月 17 日	
總單位數(註 1)	300	200	
發行日期	2024 年 3 月 13 日	2024 年 8 月 26 日	2024 年 11 月 1 日
已發行股數	19,000	20,000	15,000
尚可發行股數	0	165,000	
發行得認購股數占已發行股份總數比率	0.02%	0.02%	0.02%
認股存續期間	認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿 10 年後~存續期間屆滿	認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿 10 年後~存續期間屆滿	
履約方式	發行新股	發行新股	
限制認股期間及比率(%)	屆滿二年得執行 50%，其後每月既得四十八分之一之認股權	屆滿二年得執行 50%，其後每月既得四十八分之一之認股權	
已執行取得股數	0	0	0
已執行認股金額(新臺幣)	0	0	0
未執行認股數量	19,000	20,000	15,000
未執行認股者其每股認購價格(新臺幣)	3,374.40	2,484.50	2026.90
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0.02%	0.02%	0.02%
失效之股數(註 2)	0	0	0
對股東權益影響	於財務報表表達上，依國際會計原則處理，惟本公司之認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿二年之日起，可行使被給予 50% 之認股權，其後每月既得四十八分之一之認股權，對原股東權益之影響係逐年稀釋。	於財務報表表達上，依國際會計原則處理，惟本公司之認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿二年之日起，可行使被給予 50% 之認股權，其後每月既得四十八分之一之認股權，對原股東權益之影響係逐年稀釋。	

註 1：每一單位為 1,000 股。

註 2：因員工離職而失效與員工認股權憑證到期之股數。

2. 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

2025 年 3 月 31 日;單位：仟股；新臺幣仟元

職稱	姓名	取得認股數量 (仟股)	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行			未執行				
				已執行股數	已執行認股價格(新台幣元)	已執行認股金額(新台幣元)	已執行認股數量占已發行股份總數比率	未執行股數	未執行認股價格(新台幣元)	未執行認股金額(新台幣元)	未執行認股數量占已發行股份總數比率
執行長	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	4,898.60	6.06%	600.00	55.20	33,120.00	0.74%	0.00	55.20	0.00	0.00%
				397.00	36.30	14,411.10	0.49%	0.00	36.30	0.00	0.00%
685.00	24.40			16,714.00	0.85%	0.00	24.40	0.00	0.00%		
78.00	40.00			3,120.00	0.10%	0.00	40.00	0.00	0.00%		
181.00	81.20			14,697.20	0.22%	19.00	81.20	1,542.80	0.02%		
420.00	74.90			31,458.00	0.52%	0.00	74.90	0.00	0.00%		
38.00	95.40			3,625.20	0.05%	0.00	95.40	0.00	0.00%		
355.00	118.60			42,103.00	0.44%	0.00	118.60	0.00	0.00%		
15.85	85.40			1,353.59	0.02%	2.75	85.40	234.85	0.00%		
360.00	73.30			26,388.00	0.45%	0.00	73.30	0.00	0.00%		
副總經理	張政淵	71.00	72.60	5,154.60	0.09%	29.00	72.60	2,105.40	0.04%		
		313.00	93.40	29,234.20	0.39%	17.00	93.40	1,587.80	0.02%		
會計主管	詹舒媚	20.00	200.90	6,382.00	0.02%	0.00	200.90	0.00	0.00%		
		33.00	202.90	18,189.60	0.04%	32.00	202.90	17,638.40	0.04%		
員工	保坂 純一郎	319.73	319.10	252,872.88	0.40%	55.27	319.10	43,714.62	0.07%		
		44.00	551.20	17,441.60	0.05%	6.00	551.20	2,378.40	0.01%		
	黃建棋	106.25	790.90	100,640.00	0.13%	293.75	790.90	278,240.00	0.36%		
		66.63	396.40	56,884.43	0.08%	256.38	396.40	218,892.98	0.32%		
	廖雲濤	0.00	947.20	0.00	0.00%	36.00	947.20	28,724.40	0.04%		
		0.00	853.80	0.00	0.00%	20.00	853.80	16,476.00	0.02%		

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

世芯電子從事特殊應用積體電路(Application Specific IC；ASIC)及系統單晶片(System-on-Chip；SoC)設計及製造生產業務，尤其擅長高複雜度、深次微米先進製程晶片。

2. 主要產品之營業比重

單位：新臺幣仟元

產品	2023 年度		2024 年度	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)
ASIC 及晶圓產品	29,982,507	98.36	51,586,295	99.27
委託設計(NRE)	402,093	1.32	365,751	0.70
其他	96,976	0.32	16,524	0.03
合計	30,481,576	100.00	51,968,570	100.00

3. 公司目前之商品（服務）項目

(1) ASIC 及晶圓產品：提供特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit；ASIC)及系統單晶片(System on chip；SoC)之委託設計服務(Non-recurring engineering；NRE)與後端晶圓製造、封裝及測試之完整服務。

(2) 委託設計(Non-Recurring Engineering；NRE)：主要提供設計產品時所需的電路設計元件資料庫和各種矽智慧財產(SIP)，以及製作產品光罩組的電路圖，並委託代工廠生產光罩、晶圓、切割與封裝，再由本公司工程人員做產品測試後，交付試產樣品予客戶。

(3) 其他：提供客戶後端晶圓製造、封裝、測試的服務。

4. 計畫開發之新商品（服務）

本公司致力於尖端積體電路的研發與製造，包含開發 SoC 所需之客製化設計工具及設計方法(Design Methodology)以保證服務品質。並根據 AI/HPC 的市場需求，提供最有效的解決方案與建立相應的設計，包含芯粒技術平台、高效能運算 IP 組合，其中包含 DDR、HBM、PCIe、SerDes 等，以及最新的 2.5D/3D 先進封裝技術。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

近年來，隨著摩爾定律逼近極限，通用晶片的性能提升面臨挑戰，特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit；ASIC)憑藉其針對特定演算法的優化設計，實現了更高的運算速度和更低的功耗，成為推動科技進步的關鍵力量。本公司為專門提供高複雜度、高產量特殊應用積體電路(ASIC)及系統單晶片(SoC)設計及製造服務的公司。所屬產業現況與發展分述如下：

(1) 無晶圓廠 ASIC(Fabless ASIC)之概況

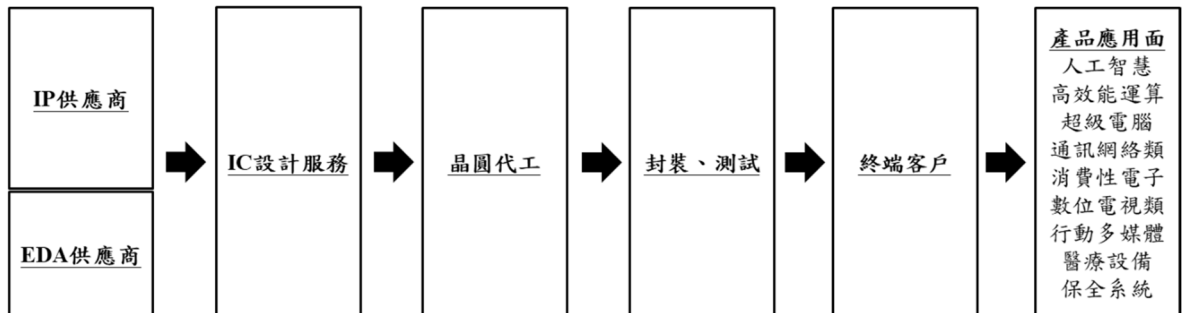
ASIC 晶片因其高性能和低功耗特性，在電子產品、電腦科學、醫療健康、汽車工業和人工智慧等多個領域得到廣泛應用。在電子設備中提升性能，在電腦科學中加速加密解密，在醫療領域支援先進設備，在汽車工業中實現智慧化，在人工智慧領域優化邊緣計算。ASIC 晶片的集成化和專用化使其成為支援技術創新和行業進步的關鍵元件。

(2) 系統單晶片(SoC)之概況

隨著半導體製程的發展，傳統 MCU 已經不能完全滿足智慧終端機的需求，SoC 應運而生，憑藉其高性能、低功耗、高靈活度的特點，使單晶片能夠完成完整的電子系統。SoC 在追求高性能和低功耗的智慧型手機、平板電腦等晶片領域已佔據主導地位，在自動駕駛、AIoT 等領域也已得到應用，隨著 AIoT、5G 的不斷發展，未來還將向更為廣闊的應用領域擴展。

2. 產業上、中、下游之關聯性

Fabless ASIC 產業，帶動含括各系統應用領域、矽智財元件(IP)、製造、封裝、測試等發展，形成專業分工各司其職的產業鏈，如下圖：



3. 產品之發展趨勢

(1) 特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit; ASIC)：現階段半導體產業中，ASIC（特殊應用積體電路）的發展受到市場需求和技術進步的雙重推動。隨著 5G、物聯網、人工智慧和自動駕駛等新興技術的快速發展，ASIC 因其高效能、低功耗和客製化能力，成為這些領域的核心組件。近年來，隨著 AI 技術的發展，尤其是生成式 AI 和大型語言模型的興起，對晶片的算力需求和能耗控制越來越高，推動了 ASIC 晶片在 AI 領域的快速發展。ChatGPT 等代表了 AI 晶片技術的新一輪突破，進一步確立了 ASIC 作為未來 AI 晶片的核心地位。在早期，ASIC 的下游應用場景主要是各領域智慧終端機設備，隨著雲端算力需求的增加，ASIC 憑藉出色的算力水準開始在雲端推斷領域快速滲透。大型模型算力需求急劇膨脹，推理 ASIC 的路徑逐漸清晰，成為 AI 晶片市場的高增長關鍵賽道。與此同時，消費電子領域不斷增長的需求也將持續推動 ASIC 市場的發展。在技術層面，ASIC 的設計和製造正不斷邁向更先進的製程節點，7nm、5nm 甚至 3nm 工藝的引入顯著提升了效能和能效。同時，3D 封裝技術的應用，進一步提高了整合度和功能複雜性。電子設計自動化（EDA）工具的進步也縮短了設計週期，降低了開發成本。

(2) 系統單晶片(System on chip; SoC)應用市場：SoC 的發展是性能、算力、功耗、工藝難度幾方面的平衡。當前 AI 成為各大 SoC 廠商的必爭之地，同時對演算法提出更高要求，在功耗受限的場景下實現 AI 演算法成為關鍵，算力效率（單位算力的成本和功耗）極為重要。SoC 在追求高性能和低功耗的智慧手機、平板電腦等晶片領域已佔據主導地位，在自動駕駛、AIoT 等領域也已得到應用，隨著 AIoT、5G 的不斷發展，未來還將向更為廣闊的應用領域擴展。此外，資料大爆炸時代對邊緣計算算力提出更高要求，智慧硬體需求量也將持續上漲。

4. 競爭情形

Fabless ASIC 公司主要的競爭對手為整合元件廠商(IDM)及其他同型公司，隨著進入深次微米世代後，由於生產成本過高，大型 IDM 廠商已日漸式微，無法與 Fabless

ASIC 公司競爭，目前大部分的 IDM 廠商均逐漸轉型成輕/無晶圓廠模式。

另外，在與其他同型公司的競爭中，產品能否及時上市為 Fabless ASIC 客戶最主要的訴求。隨著晶片的處理速度不斷提升，同時晶片功能演算法也愈趨複雜，設計人員需審慎評估如何在最短的設計週期內，針對整顆晶片的低功耗策略作定義及最佳化，並思考如何讓封裝設計包容超高的功耗，確保高速介面的訊號品質。因此，擁有專業的技術能力，並能提供整合服務的 Fabless ASIC 公司，才能在競爭激烈的情況下保持領先地位。

(三) 技術及研發概況

1. 本公司 2024 年及 2023 年度，投入之研發費用分別為新臺幣 2,141,874 仟元及新臺幣 1,546,585 仟元。

2. 開發成功之技術

世芯電子結合商用的設計軟體工具(EDA)與內部研發的設計技術，包含線路、實體設計及獨特的設計軟體工具，提供給客戶提高效能、縮小面積、降低功耗及快速完成的服務。內部研發技術如下：

- (1) 階級式實體設計 (hierarchical physical design) 及時序分配(timing budgeting)方法：此法可在晶片的設計上分為幾個部份同時進行設計的工作，同時掌握各部份的時序，以符合晶片對於時序的要求。
- (2) 實體設計(physical design)方法：此法將各種矽智財(IP)用於高密度的晶片設計，以縮小晶片面積，達到降低成本的目標。
- (3) 時序與電氣(timing and electrical)的設計方法：此法可以藉由調整一些參數以提高良率。
- (4) 時序及耗電分佈(power consumption distribution)方法：此法可以達到降低功耗，提高電氣效能。
- (5) 可測試電路的設計(DFT)方法：此法可將晶片的可測試覆蓋率極大化，優化測試向量，以降低測試時間與成本。
- (6) 產品規劃及制訂規格階段之技術：世芯電子為客戶做成本規劃，包含選擇 SoC(系統晶片)或 SiP(系統封裝)、系統成本及零件成本(BOM)規劃、製程成熟度及矽智財元件(IP)穩定度考量、次世代製程可行性(Half node)、靜態隨機存取記憶體修復與否(SRAM Repair)評估、並做測試成品選擇與解決方案。我們與矽智財元件供應商共同開發測試解決方案，建立內置測試模組(DFT, BIST)與配合可大量生產的測試機台。量產時採用兩組、四組甚至八組同時測試的線路板以節約測試成本。最後，與封裝廠研擬最合適的封裝方式，建立良好合作關係，替客戶開發最佳的成品品質與市場效益。
- (7) SoC 和 2.5D/3D 先進封裝技術：2.5D/3D 先進封裝技術在人工智慧系統單晶片設計中發揮著舉足輕重的作用。世芯電子已成功完成多個 3 奈米到 7 奈米採用 2.5D/3D 從晶片到封裝的設計案。特別的是 3D 封裝晶片的片上時鐘樹結構可支持頂層和底層晶片之間的時鐘傳輸，這種新奇而複雜的結構是可配置和可控的，且可應用於多種負責的場景。
- (8) 原型及生產階段之技術：在原型的製作及晶片量產，世芯電子以專業的設備與技術(內建測試機台和測試治具)與供應商緊密合作，幫助客戶縮短產品進入量產的時程，同時分析產品特性與敏感度，訂立量產製程條件及測試規格，並提供客戶少量的原型成品，供其製作系統工程原型機。在客戶原型機驗收過程中，世芯電子為晶片量產做準備，包括可靠性(reliability)和品質性(qualification)分析。進入量產後，持續經由良率提升與縮短測試時間，為客戶降低生產成本。

3. 最近年度開發成功之技術

- (1) 2022 年上半年完成 5 奈米 APLink IP 測試階段。
- (2) 完成 5 奈米測試晶片設計定案，並於 2022 年上半年完成投片。
- (3) 完成採用 TSMC CoWoS®先進封裝技術之 7 奈米高效能運算 (GPU) 應用設計案並成功投片。
- (4) 完成 16 奈米車用電子應用設計定案，並於 2022 年下半年成功投片。
- (5) 完成 5 奈米通訊網路設計定案，並於 2023 年下半年成功投片。
- (6) 成功與客戶進行採用 TSMC CoWoS®先進封裝技術之 3 奈米設計規劃，並於 2023 年一月完成測試晶片投片。
- (7) 完成多項採用 TSMC CoWoS®及 InFO 先進封裝技術之 7 奈米設計案投片，客戶端目前已成功進入量產。
- (8) 完成 5 奈米車用電子應用設計定案，並於 2024 年下半年成功投片。
- (9) 完成多項 5 奈米人工智慧設計定案，並於 2024 年成功投片。
- (10) 完成 2 奈米測試晶片設計定案，並於 2024 年完成投片。
- (11) 過去三年成功案例-系統大廠
 - A. AB 公司：2022 年世芯與北美客戶合作進行 16 奈米車用電子晶片設計案。
 - B. AC 公司：2023 年世芯與北美客戶合作生產先進製程 7 奈米人工智慧晶片。
 - C. AD 公司：2024 年世芯與北美客戶合作生產先進製程 5 奈米人工智慧晶片。

(四) 長、短期業務發展計劃

世芯電子未來仍持續專注其本身的核心業務-先進製程 SoC 之研發、設計及製造，並與世界級的晶片製造代工廠緊密合作，以領先的技術提升臺灣在晶片設計產業的國際地位。以下就研發、業務、生產三方面分述本公司之短期及長期的業務發展計畫。

項目	短期業務發展計畫	長期業務發展計畫
研發	1. 加速進行以提供客戶 2 奈米製程技術。 2. 加大投入資源在 2 奈米測試晶片以進行驗證和設計方法。 3. 進行高速 3D D2D (die-to-die) 介面 IP 之設計和驗證流程，以利客戶端整合 2 奈米、3 奈米晶片於 3D SoC 設計中。 4. 加大投入資源在 3D 測試晶片，與主要晶圓廠和 OSAT 供應商合作，確保 3D 封裝解決方案準備就緒。 5. 擴充低功耗和低電壓客製化數位單元產品組合，以進行 2 奈米、3 奈米晶片設計。	1. 建立 AI 輔助之 SoC 設計平臺以支持領先的半導體先進製程技術。 2. 使用 2.5D/3D 芯粒 (chiplet) 技術平臺實現 SoC 設計。 3. 發展新世代 SoW (System-on-Wafer) 設計技術，以利客戶端集成系統級設計於晶圓上。 4. 通過投資高端客製化數位積體/類比電路的研發，擴充矽智財產權庫。 5. 引入新進 SoC 設計方法和客製化電路來提高性能和節能。 6. 通過提供 SI/PI/Thermal 和 IP 子系統設計/驗證，實現系統級設計服務。
業務	1. 以系統客戶為主，選擇具市場潛力的產品，尤其在 HPC/AI 相關之應用產品。 2. 將系統客戶的現有產品導入先進製程，以降低成本與耗電。	1. 建立全球主要客戶服務據點，深耕系統客戶之長期合作關係及核心技術，提升市場知名度及佔有率。 2. 加強與矽智財供應商之策略結盟與長期合作關係。

	3. 增加系統整合如 SoC 或是 SiP。 4. 以市場導向開發客戶，尋找具發展潛力的客戶，專注於本公司四大領域客戶。	3. 與客戶合作開發各式應用平台架構，並協助客戶建立合作結盟關係，增加系統整合如 SoC 或是 SiP 的競爭力。 4. 持續加強與上下游廠商之間的合作關係，並建立更寬廣的市場資訊觸角。
生產	1. 加強上下游之合作。 2. 提供客戶優質的供應鏈管理，以創造生產的附加價值。 3. 與晶圓廠建立長期的合作關係。	1. 加強設計與生產的銜接，持續降低生產成本，提高生產良率。 2. 提供客戶更優質的供應鏈管理及更專業的後段諮詢能力，以創造生產的附加價值。 3. 與晶圓廠建立長期緊密的合作關係，包括矽智財之驗證研發。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析：

1. 2021～2025(註)年臺灣 IC 產業產值：

億新臺幣	2021	2021 成長 率	2022	2022 成長 率	2023	2023 成長 率	2024	2024 成長 率	2025 (註)	2025 成長率 (註)
IC 產業產值	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	53,151	22.4%	61,785	16.2%
IC 設計業	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,721	16.0%	14,155	11.3%
IC 製造業	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	34,195	28.4%	40,827	19.4%
晶圓代工	19,410	19.1%	26,847	19.1%	24,925	-7.2%	32,438	30.1%	38,960	20.1%
記憶體與其他製造	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,757	3.3%	1,867	6.3%
IC 封裝業	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,233	7.7%	4,608	8.9%
IC 測試業	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,002	5.0%	2,195	9.6%
IC 產品產值	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-13.7%	14,478	14.3%	16,022	10.7%
全球半導體市場(億美元)及 成長率(%)	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,269	-8.2%	6,276	19.1%	6,979	11.2%

註：2025 年為預估值。

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/02)

臺灣半導體產業協會 (TSIA) 表示，根據 WSTS 統計，2024 年全球半導體市場全年總銷售值達 6,276 億美元，較 2023 年成長 19.1%。全球通膨趨緩、終端市場買氣逐步回溫，加上 AI 新興應用需求攀升，不斷引領半導體產業快速成長。2024 年美國半導體市場總銷售值達 1,946 億美元，較 2023 年成長 44.8%；日本半導體市場銷售值達 466 億美元，較 2023 年衰退 0.4%；歐洲半導體市場銷售值達 513 億美元，較 2023 年衰退 8.1%；中國大陸市場銷售值達 1,825 億美元，較 2023 年成長 18.3%；亞太地區半導體市場銷售值達 1,527 億美元，較 2023 年成長 12.5%。隨著全球經濟復甦與 AI 人工智慧驅動，半導體市場景氣回溫。工研院產科國際所預估 2024 年台灣 IC 產業產值達新臺幣 53,151 億元(USD\$165.6B)，較 2023 年成長 22.4%。其中 IC 設計業產值為新臺幣 12,721 億元(USD\$39.6B)，較 2023 年成長 16.0%；成長主要來自前一年低基期與終端電子產品市場緩步復甦，以及全球智慧型手機與 AI PC 等新產品上市，帶動了相關晶片需求回升；邊緣 AI 運算需求增加，拉升了高效能晶片出貨；通訊

技術升級也驅動了設備更新需求等，皆推動了臺灣IC設計業全年在AI、通訊與消費性應用市場各領域呈現顯著成長。

■ 趨勢一：專業分工的產業

半導體產業直到八零年代初期，主要為垂直整合上、中、下游的封閉生產體系，系統公司包辦所有的項目。自1987年第一家專業晶圓代工廠台積電及聯華電子的成立，專業晶圓代工的商業模式正式確立。2000年以後除大型IDM仍擁有IC設計與晶圓廠外，半導體產業的專業分工愈來愈明顯，如今，系統公司專注於研發核心技術以及經營其品牌行銷，將後端設計及生產供應鏈管理委託給無晶圓廠 ASIC (Fabless ASIC)公司，Fabless ASIC公司與策略合作夥伴結盟，形成專業分工的產業。

■ 趨勢二：先進製程取代成熟製程

ASIC 設計追求先進製程以降低成本、降低功耗及縮減體積。根據國際市場研究機構 Allied Market Research 指出，過去 2018 年全球 ASIC 晶片市場規模約 148.7 億美元，而隨著 5G、人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)、車用電子(Automotive)等應用需求增加，加上晶圓代工業者持續推動先進製程，並積極布局 2.5D/3D IC 封裝技術，以延續摩爾定律發展，預估至 2026 年全球 AISC 晶片市場將達到 280.5 億美元，2019 至 2026 年年複合成長率(CAGR)可望達 8.61%。

■ 趨勢三：系統整合逐漸走向系統單晶片設計 (SoC) 與系統級封裝 (SiP)

系統產品市場競爭激烈，較短的開發時間和具成本效益的設計為客戶首要需求。ASIC設計除了矽智財的整合，也是系統層次的整合；在追求先進製程，需要將晶片封裝測試技術納入考量，以取得成本、耗電、體積的競爭優勢。為了因應全新的SoC可能需要耗費大量的時間和金錢，SiP堆疊封裝技術因而產生。與傳統的IC封裝相比，SiP封裝技術可減少設計時間、增加封裝密度、降低風險與節約系統成本支出。未來系統單晶片漸走向跨平台的合作，透過SiP整合SoC的模式，將各平台作最具競爭力的整合。

■ 趨勢四：系統廠商將逐漸走向將ASIC外包設計及生產

在市場需求量大且功能多樣化、成本競爭激烈的背景下，相機、平板電腦和智慧手機等系統產品的主要廠商面臨著巨大的成本和未來競爭壓力。為了獲得差異化和競爭優勢，這些廠商開始轉向自行開發 ASIC (專用積體電路) 的策略。與此同時，隨著汽車逐漸演變為高度互聯的智慧載具，車用晶片的專用化需求也愈發明顯。ASIC 的應用成為滿足汽車智能化和電動化發展需求的關鍵技術，並為產業創新提供了強大的推動力。在這一趨勢下，系統廠商更加專注于掌握核心的固件和軟體技術，而將 ASIC 的設計和生產逐漸外包。此外，隨著 AI 算力需求的不斷增長，雲服務商的耗電量持續上升，面臨高成本和高算力的運營挑戰。ASIC 憑藉其高性能和低功耗的優勢，成為大型雲服務商開發特定算力需求產品的優選方案。整體來看，ASIC 在多個領域的重要性日益凸顯，成為推動技術進步和產業升級的關鍵因素。

2. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣仟元

銷售地區	2023 年度		2024 年度	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)
臺灣	2,743,303	9.00	601,460	1.16
日本	1,919,287	6.30	802,591	1.54
中國大陸	3,873,414	12.71	4,679,049	9.00
歐洲	2,401,017	7.88	1,164,203	2.24

美國	19,237,266	63.11	44,721,267	86.06
其他	307,289	1.00	-	-
合計	30,481,576	100.00	51,968,570	100.00

3. 市場占有率

本公司為從事 ASIC/SoC 設計服務的領導廠商，服務範圍涉及全球，在業界具有規模及獨特性，在國內設計服務業排名中亦有亮麗表現。

4. 市場未來之供需狀況與成長性

隨著系統單晶片的應用層面越來越廣與終端產品多元化的需求，IC 製造商與設計業者明顯感受到其設計生產力遠不及製程技術之精進，為達縮短產品上市時間、降低 IC 設計成本的目標，系統廠商需與有能力整合不同矽智財的 Fabless ASIC 業者合作，因而 Fabless ASIC 需求將日益成長。

以各區域的成長情形來看，北美龐大的內需市場為其成長動力，將是未來著重發展的區域。本公司長期積極研發 FinFET 製程（16 奈米及以下）的設計流程與技術，針對一般商用研發設計軟體（EDA）的使用進行改良，並加強供應鏈管理，通過豐富的設計資源與技術支援，使客戶群的產品能領先市場，而本公司在 2024 年的營收也能持續成長。

5. 競爭利基

(1) 先進製程經驗：

目前絕大部分 Fabless ASIC 公司技術經驗仍停留在 28 奈米或其以上節點，世芯電子設計團隊專注於先進製程(7 奈米及以下)、高複雜度(大於 50 billion transistors)的設計案，成功為世界級的系統公司開發並量產一系列的系統級晶片，對於 electrical closure(包含電源管理、時序收斂、系統介面及信號完整性)、可測性設計(Design for Test；DFT)、可製造性設計(Design for Manufacturing；DFM)或系統層級的挑戰都能有效的解決，進一步縮短設計時程及提升晶片效能，幫助客戶降低成本、增加生產效能、減少功耗以及晶片尺寸最佳化。

(2) 客製化服務：

本公司為滿足客戶的需求，提供適度的靈活度配合客戶替其打造客製化的設計。世芯的市場定位在於高複雜度及先進製程的 SoC 設計，對於客戶的要求都會先做充分的溝通與瞭解，提供從設計到量產的全方位服務，並將客戶未來將上市之產品所需的矽智財納為本公司之研發計畫，提前做好準備以縮短日後的設計時程。

(3) 品質保證：

世芯的目標是開發與提供最高品質的解決方案給客戶，達到最高卓越標準，並持續提升創新力。為協助客戶掌握市場的先機，本公司在設計階段即導入可測試性(DFT)的方法，在晶片上增設硬體電路，使晶片在測試時能檢測出瑕疵，進而降低測試成本，並強化晶片量產的良率，確保每項工作皆能快速有效地完成，降低 IC 設計的風險。同時，世芯也實行嚴格的品質政策，持續檢討及強化其服務，以使用高時效性、高度成本效益的方式，完成客戶所交付的各工作項目，確保產品與品質能合乎客戶的需要。

(4) 掌握先進製程設計技術：

本公司核心團隊掌握先進製程的設計能力，對於先進製程的變異性皆有相當了解，對於一般商用 EDA 軟體因缺乏先進製程的變異所產生的風險，能夠適度的預測及規避。尤其是在先進製程中系統更為複雜，為確保晶片的可預測性，於晶片設計及封裝過程中亦將系統分析考量進來，以確保客戶將晶片整合進系統的可預測性，如：SI(Signal Integrity)、PI(Power Integrity)。世芯的先

進製程設計解決方案已在超過 2 億顆量產晶片中獲得實證，客戶採用世芯的設計方案，能在最短時間完成產品設計的目標並在高量產下得到成本效益。

(5) 可靠性：

高複雜度的 SoC 設計面臨著可靠性、品質、成本以及產品上市周期的挑戰，本公司自 2003 年成立已完成超過 480 個設計專案，並獲得世界級系統公司的品質認證。世芯電子在電路的設計初期即考慮可能發生的環境變異因素，減少重新設計(re-design)、再次光罩(re-spin)的時間與成本，以實現高良率。世芯透過縝密的規劃、執行，以及對可靠度的專注、售前支援及持續改善相關產品可靠性，以達成可靠度保證。

(6) 長期的客戶關係和策略結盟夥伴：

本公司和客戶之間皆有長期合作關係，共同追求越做越好、越做越快、成本越來越低的目標。在供應鏈管理部分，也和上下游之策略夥伴維持良好的合作關係，提供客戶完整的解決方案及更具競爭力的產品。

6. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

A. 臺灣半導體的產業供應鏈完整：半導體產業分工專業且上下游關係密切，臺灣擁有製程先進的晶圓、封裝、測試廠商及完整的衛星廠商，對於發展 IC 設計服務相當有利，加上地理位置的便利性，吸引全球的廠商在臺灣下單，擁有一流的國際競爭力。近年來，隨著全球半導體供應鏈的重組，臺灣在先進制程（如 3nm、2nm）領域的領先地位更加凸顯，成為全球半導體產業的核心樞紐。

B. 臺灣具有大量的半導體產品需求：臺灣不僅在半導體代工領域佔據主導地位，在系統產品製造代工方面也展現出極高的生產效率和規模經濟優勢。臺灣的內需市場龐大，能夠有效支援國外廠商的訂單需求。隨著高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、5G 通訊網路、自動駕駛等技術的快速發展，對高性能運算及 AI 晶片的需求持續增長。特別是在全球數位化轉型加速的背景下，先進系統晶片設計業的前景更加廣闊。此外，地緣政治因素促使全球供應鏈多元化，臺灣作為半導體製造重鎮，其戰略地位進一步提升。

C. 政府的政策支持：電子產業一直受到政府大力支持，投入製造代工(OEM)、設計代工(ODM)到半導體產業，培植資訊、消費性電子及 IC 製造產業，使得人才和產業結構都有利於長期發展。近年來，政府更積極推動半導體產業的本土化與國際化並行策略，鼓勵企業參與全球競爭，同時加強本土供應鏈的韌性。

(2) 不利因素與因應對策：

A. 對於有先進製程經驗的工程師有限、人才尋求及養成不易且 IC 產業蓬勃發展，專業人員的取得日益競爭，公司往往需付出高額成本網羅優秀人才，因此為凝聚對員工公司的向心力，公司所付出之人力成本也較高。

【因應措施】

本公司透過內部與外部的專業教育訓練與在職訓練，長期自行培育自有人才，並提高員工福利，降低流動率。

B. 產業前景看好，設計資源需求日增，需積極擴充設計資源以提升服務品質。IDM 之產業模式已漸不具競爭力，系統客戶尋求合作夥伴的市場趨勢已經漸漸明顯；目前的設計服務業者之規模有限，需要擴充規模以贏取國際級系統公司的大單。

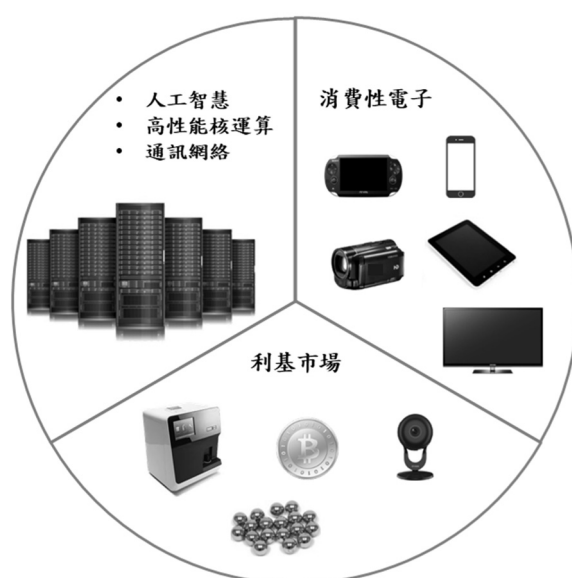
【因應措施】

- 簡化開發設計流程以提高生產力。
- 建立特定應用的矽智財平台，縮短設計時程及資源投入。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途：

- (1) 世芯電子的主要產品共分三大類別：人工智慧/高效能運算/通訊網絡市場：網路、儲存及運算設備正在成長，這些設備為了滿足更高的效能標準，必須使用日益複雜的高效能、高密度系統單晶片。本公司與日本超級電腦業者完成多項高效能運算（HPC）系統晶片設計，並在 Green500 排行榜中名列前茅。除此之外，亦與北美大廠完成多項高效能運算系統晶片，在歐美亦為知名高效能運算及人工智慧系統客戶提供先進製程之晶片設計與量產。
- (2) 消費性電子產品：包含高解析度電視、手機、數位相機/攝影機、娛樂系統、可攜式媒體播放器，平板電腦主晶片及周邊晶片等應用領域之設計。在半導體產業中，消費性市場是成長最快的區段，為因應激烈的市場競爭，世芯提供可預估的晶片實現時程、採行已歷經實證的應用功效電路、儘速完成原型晶片，及儘速進入大量生產，使客戶的投資獲得最大報酬。
- (3) 利基市場產品：含車用電子、監視系統、娛樂機台與醫療設備器材等特殊應用領域的 ASIC 設計。



2. 主要產品之產製過程：

晶片設計是由前端設計和後端設計所組成，前端設計由系統公司提供，後端設計及生產製造即委託給世芯電子。

在前端設計中，由客戶決定產品的概念，以 Register Transform Level (RTL) 描述 IC 所需功能，並決定產品的運作速度，最後建立一個包含所有細節（基本功能邏輯）的目標資料庫。通過運用合成軟體 (Synthesis Software)，將 RTL 轉換為 Netlist，在 Netlist 中將電子線路轉換為邏輯閘，並將所定義的功能，以合成軟體實現，同時優化設計師所定義的運作時脈，把完成的設計交由 Fabless ASIC 廠商做後端設計。

後端的設計分為兩個階段，第一階段為設計案起始至收到客戶最終 Netlist，第二階段為工程師使用實體設計軟體將 Netlist 轉換為實際的佈線，產生一個稱為 GDSII 的檔案，以製造光罩 (俗稱 Tapeout)。

- 概念
- 架構設計
- RTL設計
- 合成

- 矽智財解決方案
- 版圖規劃
- 實體合成
- 電子設計
- 佈局 & 繞線
- 時序優化
- 電子優化
- 驗證

- 光罩製作
- 製造
- 組裝 / 封裝 / 測試
- 原型品研究
- 品管 / 系統測試
- 生產
- 持續性提升良率

世芯電子除了提供後端設計服務，也提供客戶從設計到晶圓製造、封裝及測試的一站式(Turnkey)完整服務。在世芯電子的服務流程中，晶圓製造階段是從將 GDSII 的檔案交付給晶圓廠製造開始算起。晶圓製造過程可概分為晶圓處理製程 (Wafer Fabrication)、晶圓針測製程 (Wafer Probe)、封裝 (Assembly)、測試製程 (Initial Test and Final Test) 等幾個步驟。世芯電子與整體後端設計生產的供應商，皆有緊密的合作關係。

- (1) 矽智財供應商：世芯電子與各個矽智財(IP)供應商緊密的合作，謀取最適合的性價比。全球主要的 IP 供應商的產品，世芯都可以提供，客戶可採用自主 IP，再靈活搭配世芯提供的 IP。
- (2) 晶圓廠：世芯電子依據客戶需求選擇合作廠商，採用的開放式晶圓廠的商業模式，不需依附固定晶圓廠限制本身的設計能力及發展。本公司與大部分晶圓廠皆有良好的合作關係，在深次微米先進製程上 SoC 後端設計的研發，世芯也與台積電緊密合作。
- (3) 封裝測試廠：考量產品生產時的封裝測試，設計之初，世芯電子製造生產團隊與設計工程團隊將會和客戶以及供應鏈中的封裝測試廠一起合作，確保產品化的過程中每個環節無誤。同時世芯電子的生產管理團隊透過良善規劃的生產流程，以及與供應鏈廠商的良好互動，讓晶片能及時生產，交付客戶。

(三) 主要原料之供應狀況

本公司產品之主要原料為晶圓，主要供應商為專業晶圓代工廠商台灣積體電路製造股份有限公司(TSMC)，本公司與 TSMC 公司長期配合並建立穩健之合作關係。

(四) 最近兩年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之供應商及客戶名稱

1. 最近二年度任一年度中曾佔進貨總額百分之十以上之供應商

單位：新臺幣仟元

2023 年度					2024 年度				2025 年截至年報刊印日前(註 2)			
項目	名稱	金額	佔全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔當年度截至前季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	廠商 A	10,570,901	48.47	無	廠商 A	25,768,779	78.46	無	-	-	-	-
2	廠商 B	5,365,874	24.60	無	廠商 B	3,994,536	12.16	無	-	-	-	-
3	廠商 C	2,182,491	10.01	無	廠商 C	(註 1)	(註 1)	無	-	-	-	-

註 1:對該廠商之進貨未達本公司該年度進貨總額 10%以上，故不予揭露。

進貨變化主要係因產品銷售組合差異，致影響向供應商的進貨需求。

註 2:截至刊印日止，尚無經會計師查核簽證之資料。

2. 最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額百分之十以上之客戶名稱

單位：新臺幣仟元

2023 年度					2024 年度				2025 年截至年報刊印日前(註 2)			
項目	名稱	金額	佔全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔當年度截至前一年季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	客戶 A	17,742,729	58.21	無	客戶 A	31,266,294	60.16	無	-	-	-	-
2	客戶 B	(註 1)	(註 1)	-	客戶 B	11,006,697	21.18	無	-	-	-	-

註 1:對該客戶之銷貨未達本公司該年度銷貨總額 10%以上，故不予揭露。

2024 年度客戶 B 銷貨增加係因客戶晶片量產訂單需求提升，致晶片量產出貨增加。

註 2:截至刊印日止，尚無經會計師查核簽證之資料。

三、從業員工

本公司最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數，平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：

單位：人

年 度		2023 年度	2024 年度	當 年 度 截 至 2025 年 3 月 31 日止
員工 人數	經理級以上主管	145	144	139
	一 般 職 員	433	453	456
	合 計	578	597	595
平 均 年 歲		32.9	33.6	34.5
平 均 服 務 年 資		6.1	5.4	5.6
學歷 分佈 比率	博 士	0.7%	0.5%	0.5%
	碩 士	36.2%	37.4%	38.0%
	大 專	62.6%	61.6%	60.8%
	高 中 以 下 (含)	0.5%	0.5%	0.7%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

五、勞資關係

(一) 公司各項福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施

本集團之員工福利措施，依各子公司所在地之相關法令規定辦理，包含勞健保、團體保險、退休金提撥及年度健康檢查。本集團各子公司亦設有員工福利委員會，負責規劃辦理員工之相關福利事項，包含年節禮金、員工旅遊、定期團康活動及年終尾牙。

2. 員工健康管理

為了提供員工一個安全健康的職場，我們致力於確保同仁的整體健康。依據職業安全衛生法及勞工健康保護規則的規範，公司制定了年度健康服務計畫，並按照以下四大計畫服務範疇進行執行及管理，以下為相關具體措施與實施成效：

(1) 員工健康保護措施執行

- 臨場服務介紹：包括臨場服務護理師及醫師服務。
- 企業健康管理：包括工作環境危害辨識及勞工健康分析。

(2) 四大計畫執行

- 異常工作負荷：管理與減輕員工的工作負荷。
- 人因肌肉骨骼預防：提供預防措施以保護員工的肌肉骨骼健康。
- 母性健康保護：支持並保護孕婦及產後員工的健康。
- 執行職務不法侵害：保護員工免受職場侵害。

(3) 職場健康促進

- 滿意度調查：定期調查員工對健康促進措施的滿意度。

(4) 健康資訊宣導

- 健康時事電子報：每月發布健康相關資訊。
- 其他相關服務連結：提供員工連結其他健康相關服務的資訊。

(5) 每年定期舉辦健康檢查及健康講座，協助員工管理健康狀況，包括工作壓力調節、心血管疾病預防及減重飲食管理等課程，以提升員工的健康意識及工作效能。

項目	2024 年
年度健康檢查	員工的受檢率達 98%，共計 112 位員工參與
員工健康調查	• 異常工作負荷調查 • 肌肉骨骼症狀調查 • 執行職務遭受不法侵害風險評估調查
醫師及護理師諮詢	• 健康檢查後追蹤 58 人次 • 異常負荷促發疾病 18 人次 • 人因性肌肉骨骼危害 11 人次 • 共計 87 人次
健康講座	舉辦 2 場健康講座，講座內容滿意度平均達 98%，共計 81 人次參與

3. 進修及訓練情形

本公司為提昇員工之專業能力及達成企業培育人才之目標，每年依公司發展策略及員工之需求訂定員工之年度訓練計畫，並依 ISO 訓練管理程序確實執行訓練並定期做訓練績效的檢討及稽核。

4. 退休制度與實施狀況

世芯電子依據「勞動基準法」及「勞工退休金條例」制定員工退休辦法，適用勞動基準法舊制退休金規定者，依勞動基準法按月提撥退休準備金存入由中央信託局開立之“退休基金專戶”，並由公司勞工退休準備金監督委員會監督之；適用勞工退休金條例退休金新制度者，公司依法每月幫員工提撥百分之六之勞工退休金至勞工退休金個人專戶。

5. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本集團一向重視員工權益及員工意見，勞資關係和諧，員工可透過定期之勞資會議進行溝通並提供公司營運之建議。

6. 員工人身安全與工作環境的保護措施

本公司為善盡企業之社會責任及提供同仁一個安全與衛生的工作環境，除了遵循相關職業安全衛生法令要求，訂定勞工安全工作守則、性騷擾防治措施等辦法，還有具體施行內容如下：

- 安全的辦公環境

為了確保員工工作環境之安全，員工進出辦公室、電梯及停車場必需感應磁卡，訪客來訪需進行登記並由員工引導進入會議室，辦公區主要出入口皆設有保全及監視系統。

- 定期消防安檢

公司每年進行一次消防安全檢查，確保防火相關器材及感應器維持在良好的狀態；以及安排每年一次消防演練。

- 環境衛生維護

(1) 年度定期冷氣、送風機之維護。

(2) 每年二次二氧化碳濃度檢測。

(二) 說明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

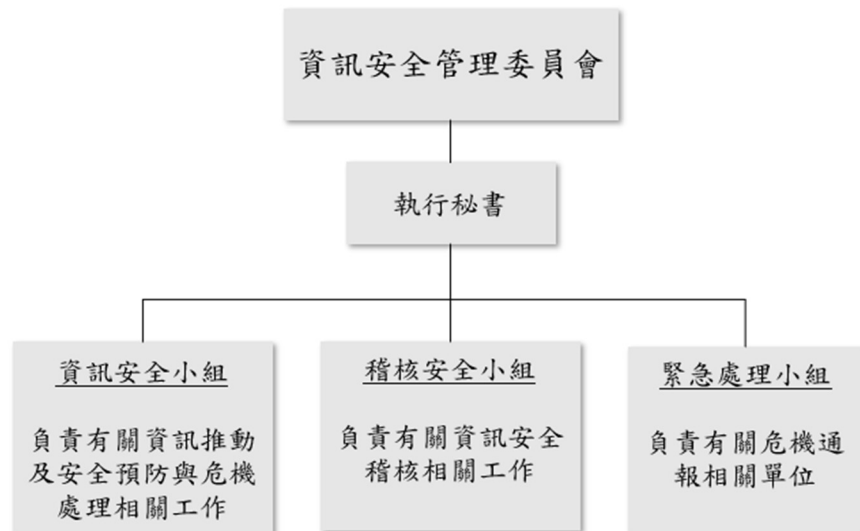
(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1. 資通安全風險管理架構

(1) 企業資訊安全治理組織

本公司民國110年設立資訊安全管理委員會為公司資訊安全事件決策機構，訂定的資安策略，確保內部遵循資安相關準則、程式與法規，由資訊安全小組負責有關資訊安全預防及危機處理相關工作，稽核安全小組負責有關資訊安全稽核相關工作，負由緊急理處理小組負責有關危機通報相關工作。

(2) 本公司資訊安全管理小組組織架構



2.資通安全政策

公司資訊安全小組為有效落實資訊安全管理，透過涵蓋臺灣與海外分公司各單位的小組成員，每年召開一次資訊安全管理委員會議，依據規劃、執行、查核與行動的管理循環機制，檢視資訊安全政策適用性與保護措施，並定期與資訊安全委員會回報執行成效。

- (1) 規劃階段：著重資訊安全風險管理，建立完整的資訊安全管理系統，從系統面、技術面、程式面降低企業資訊安全威脅，建立符合客戶需求、最高規格的機密資訊保護服務。
- (2) 執行階段：構建多層資訊安全防護，持續導入資訊安全防禦創新技術，將資訊安全控管機制整合內化於軟硬體維運、供應商安全管理等日常作業流程，系統化監控資訊安全，維護公司重要資產的機密性、完整性及可用性。
- (3) 查核階段：積極監控資訊安全管理成效，依據查核結果進行資訊安全指標衡量及量化分析，並透過定期類比演練資訊安全攻擊進行資訊安全成熟度評鑑。
- (4) 行動階段：以檢討與持續改善為本，落實監督、稽核確保資訊安全規範持續有效；當員工違反相關規範及程式時，依據資訊安全違規處理流程進行處置，並視違規情節進行人事處分（包括員工當年度考績或採取必要的法律行動）；此外，亦依據績效指標及成熟度評鑑結果，定期檢討及執行包含資訊安全措施、教育訓練及宣導等改善作為，確保公司重要機密資訊不外泄。

3.具體管理方案

資訊安全管理系統之運作，需滿足及達成內外部利害關係方之要求與期盼，包括法令及相關協議之要求，有效確保重要資訊應有之機密性、完整性、可用性、適法性。

- (1) 資訊安全目標須與政策一致性，並須定期評估其適用性。
- (2) 須清楚定義資訊安全相關工作職掌及權限。
- (3) 本公司應對資訊安全管理系統所訂定之各項作業規範，落實執行並持續改善與精進。
- (4) 當系統或程序進行變更時，不得影響既定之資訊安全承諾與協議。
- (5) 保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的修改，確保其正確完整。
- (6) 建立跨部門之資訊安全組織，制訂、推動、實施及評估改進資訊安全管理事項，確保本公司具備可供業務持續運作之資訊環境。
- (7) 執行資訊安全風險評估機制，提升資訊安全管理之有效性與即時性。
- (8) 實施資訊安全內部稽核制度，確保資訊安全管理之落實執行。
- (9) 辦理資訊安全教育訓練，推廣員工資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。
- (10) 訂定特定主題政策以能接續相對應之控制項目或措施。

4.投入資通安全管理之資源

- 資訊安全小組配有3個安全人員負責安全相關的工作。
- 落實個人電腦及伺服器防毒軟體端點防護保護端點安全。
- 外網防火牆設備具有應用程式辨識能力、入侵防護及進階威脅防護等機制，強化外部攻擊行為的防禦能力。
- 身份識別模組區分員工及訪客的身份，隔離訪問及存取路徑。
- 垃圾郵件防護除了基本垃圾郵件辨識外，導入智慧進階威脅學習防護模組，強化釣魚信件內容辨識能力以防護機敏資料騙取行為。
- 每年一次弱點掃描系統隨時掌握系統漏洞並持續追蹤及改善。

- 關鍵應用登錄認證使用二次驗證降低帳號被竊取的風險。
- 落實員工的安全教育訓練，提高員工資安意識與能力。除了將機密資訊管制相關內容，列為新進人員的必訓課程外，每年所有員工均必須進行一次資安教育複訓，以期能不斷強化與提升員工資安意識。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

世芯電子日常營運中常面臨各類網路安全威脅，包括電子郵件遭遇惡意登錄嘗試、釣魚郵件侵擾，以及公司網站遭受 DDoS 攻擊等情況。在公司完善的防護機制下，這些攻擊均未造成實際損害。

公司於 2024 年 10 月 7 日及 2025 年 1 月 3 日兩次發布資安事件重訊，兩次事件均因公司官網遭受 DDoS 攻擊，導致網站載入緩慢。針對上述情況，公司在發現攻擊後第一時間啟動了相關防護機制，迅速恢復了網站服務；同時通過進一步全面檢查，確認未發生資料遺失，此次事件對公司正常營運未造成重大影響。

七、重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約列示如下：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
合作夥伴	F 公司	2009 年 3 月 13 日起 1 年（每年自動續約一年）	F 公司委任世芯電子成為其價值鏈供應商「Value Chain Aggregator」	無
軟體授權及維護	G 公司	2022 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 30 日	G 公司授權世芯電子得使用授權產品（Licensed Products）之權利	無
軟體授權及維護	G 公司	2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 2 日	G 公司授權世芯電子得使用授權產品（Licensed Products）之權利	無
技術授權	G 公司	2022 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日	G 公司授權世芯電子得使用相關專利技術	無
技術授權	G 公司	2023 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日	G 公司授權世芯電子得使用相關專利技術	無
技術授權	G 公司	2023 年 9 月 29 日至 2026 年 9 月 28 日	G 公司授權世芯電子得使用相關專利技術	無
技術授權	G 公司	2024 年 10 月 24 日至 2027 年 10 月 23 日	G 公司授權世芯電子得使用相關專利技術	無
軟體授權及維護	H 公司	2023 年 6 月 6 日至 2026 年 6 月 4 日	H 公司授權世芯電子得使用授權產品（Licensed Products）之權利	無
軟體授權及維護	H 公司	2024 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 1 日	H 公司授權世芯電子得使用授權產品（Licensed Products）之權利	無
軟體授權及維護	AH 公司	2024 年 1 月 5 日至 2027 年 1 月 4 日	AH 公司授權世芯電子得使用授權產品（Licensed Products）之權利	無

設計與生產	AE 公司	2018 年 2 月 26 日 起迄今	世芯電子根據契約和所附之工作說明提供產品研發設計服務，製造並出售積體電路產品予 AE 公司	無
設計與生產	AK 公司	2017 年 5 月 29 日 起迄今	世芯電子根據契約和所附之工作說明提供產品研發設計服務，製造並出售積體電路產品予 AK 公司	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析：

單位：新臺幣仟元

項目	2023 年	2024 年	差異	
			金額	%
流動資產	29,416,017	46,183,878	16,767,861	57.00
不動產、廠房及設備	1,160,441	1,775,456	615,015	53.00
無形資產	413,657	247,930	(165,727)	(40.06)
其他非流動資產	92,775	100,496	7,721	8.32
資產總額	32,458,201	50,309,355	17,851,154	55.00
流動負債	14,245,636	10,671,689	(3,573,947)	(25.09)
非流動負債	178,148	160,820	(17,328)	(9.73)
其他負債	-	-	-	-
負債總額	14,423,784	10,832,509	(3,591,275)	(24.90)
股本	743,187	806,485	63,298	8.52
資本公積	10,419,696	25,350,477	14,930,781	143.29
保留盈餘(待彌補虧損)	6,124,764	10,752,247	4,627,483	75.55
其他權益	726,467	2,546,513	1,820,046	250.53
權益總額	18,034,417	39,476,846	21,442,429	118.90
一、重大變動項目說明：(兩期變動超過20%以上，且變動金額達一仟萬元以上) (1) 流動資產：係因2024年銀行存款增加所致。 (2) 不動產、廠房及設備：係因2024年購置機器設備增加所致。 (3) 無形資產：係因2024年購入矽智財減少所致。 (4) 流動負債：係因2024年客戶預收款減少所致。 (5) 資本公積：係因2024年發行海外存託憑證及現金增資-私募發行新股之普通股增加所致。 (6) 保留盈餘：係因2024年度獲利所致。 二、上述變動對本公司並無重大影響。				

二、財務績效分析：

(一)最近二年度財務績效分析比較

單位：新臺幣仟元

項目	2023 年	2024 年	差異	
			金額	%
營業收入淨額	30,481,576	51,968,570	21,486,994	70.49
營業成本	23,687,225	41,767,567	18,080,342	76.33
營業毛利	6,794,351	10,201,003	3,406,652	50.14
營業費用	3,033,079	3,704,636	671,557	22.14
營業淨利	3,761,272	6,496,367	2,735,095	72.72
營業外收入及支出	436,392	1,311,780	875,388	200.60
稅前淨利	4,197,664	7,808,147	3,610,483	86.01
所得稅費用	877,148	1,361,607	484,459	55.23
本期淨利	3,320,516	6,446,540	3,126,024	94.14
其他綜合損益(稅後)	(19,138)	1,820,046	1,839,184	9,610.12
本期綜合損益總額	3,301,378	8,266,586	4,965,208	150.40
歸屬於本公司業主淨利	3,325,170	6,445,719	3,120,549	93.85
歸屬於本公司業主綜合損益總額	3,306,032	8,265,765	4,959,733	150.02
一、重大變動項目說明：(兩期變動超過 20%以上，且變動金額達一仟萬元以上)				
(1) 營業收入：係因 2024 年晶圓產品量產收入增加所致。				
(2) 營業成本：係因 2024 年晶圓產品量產增加，相關營業成本增加所致。				
(3) 營業費用：係因 2024 進行薪資調整，致薪資費用增加。				
(4) 營業毛利、營業淨利、稅前淨利、本期淨利、歸屬於本公司業主權益：係因 2024 年營業收入增加所致。				
(5) 所得稅費用：係 2024 年稅前淨利增加所致。				
(6) 其他綜合損益：係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。				
二、上述變動對本公司並無重大影響。				

(二)預期銷售數量與其依據

展望 2025 年，隨著 7 奈米 AI 晶片對北美客戶的出貨逐步結束，整體銷售表現預期將趨於平穩。然而，NRE（委託設計）需求與專案開發動能仍維持強勁，AI 及網路相關應用的需求持續攀升，製程技術也將從 7 奈米/5 奈米逐步邁向 5 奈米/3 奈米節點。2025 年將啟動多個 2 奈米專案，預期更具優勢的產品組合將有助於進一步提升整體獲利率。

(三)對公司未來財務之可能影響及因應計畫

本公司財務結構穩健，並持續深化公司營運管理及成本費用合理管控，足以因應未來業務成長所需。

三、現金流量：

(一) 最近年度現金流量變動情形分析：

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	2023 年	2024 年	差異	
			金額	%
營業活動	9,305,958	3,357,883	(5,948,075)	(63.92)
投資活動	(5,118,495)	(676,463)	4,442,032	86.78
籌資活動	1,275,667	12,855,040	11,579,373	907.71
變動分析：				
(1) 營業活動：2024 年營業活動淨現金流入，係因 2024 年客戶預收款減少所致。				
(2) 投資活動：2024 年投資活動淨現金流出，係因 2024 年定期存款增加、購置機器設備及無形資產增加所致。				
(3) 籌資活動：2024 年籌資活動現金流入，係因 2024 年發行海外存託憑證及現金增資-私募增加所致。				

(二) 未來一年現金流動性分析及流動性不足之改善計畫：本公司自有資金充足，尚無現金不足之虞。

(三) 未來一年現金流量分析

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額(1)	預計全年來自營業活動淨現金流量(2)	預計全年來自投資及融資活動之現金流量(3)	預計現金剩餘(不足)數額(1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
27,044,210	4,917,750	(4,215,135)	27,746,825	無	無
1. 變動情形分析：					
(1) 營業活動：預計 2025 年度淨現金流入，係因 2025 年度稅前淨利所致。					
(2) 投資活動：預計 2025 年度淨現金流出，係因 2025 年度購買機器設備及矽智財。					
(3) 籌資活動：預計 2025 年度淨現金流出，係因 2025 年度發放現金股利。					
2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：

單位：新臺幣仟元

項目	2024 年投資(損)益	轉投資政策	獲利或虧損原因	改善計劃	未來一年投資計畫
香港世芯電子	1,016,534	轉投資大陸孫公司	為控股公司，認列大陸孫公司投資利益	不適用	無
美國世芯電子	(36,226)	提供產品技術支援及諮詢服務	營運狀況穩定	不適用	無
日本世芯電子	13,051	提供產品技術支援及諮詢服務	營運狀況穩定	不適用	無
臺灣世芯電子	(37,902)	提供 ASIC 及 SoC 服務	營運狀況穩定	不適用	無
Alchip BVI	6,883	一般投資	營運狀況穩定	不適用	無

馬來西亞世芯電子	(9,215)	提供研發支援服務	營運狀況穩定	不適用	無
越南世芯電子	1,668	提供研發支援服務	營運狀況穩定	不適用	無
上海世芯電子	782,240	提供研發支援服務	營運狀況穩定	不適用	無
無錫世芯電子	72,707	提供研發支援服務	營運狀況穩定	不適用	無
合肥捷芯科技	58,100	提供研發支援服務	營運狀況穩定	不適用	無
濟南世芯電子	78,450	提供研發支援服務	營運狀況穩定	不適用	無
廣州世芯電子	23,585	提供研發支援服務	營運狀況穩定	不適用	無
重慶世芯電子	151,177	提供研發支援服務	營運狀況穩定	不適用	無
矽雲(上海)科技	1,525	軟件開發及研發支援服務	營運狀況穩定	不適用	無

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項評估：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率：

本公司 2024 年度利息收入為新臺幣 1,202,671 仟元，利息費用為新臺幣 8,980 仟元，佔年度營業收入及損益比率分別為 2.3%、18.6%、0.02%及 0.14%。

本公司之利率風險主要來自銀行存款及租賃負債，利率變動會影響公司現金及約當現金及按攤銷後成本衡量之金融資產產生之利息收入及租賃負債產生之利息費用，本公司現金及約當現金及按攤銷後成本衡量之金融資產之利息收入可能因利率下跌而減少，租賃負債為固定利率，利率變動不會影響帳面金額。有關利率風險之敏感度分析主要針對財務報導期間結束日之利率暴險而決定。若利率增加／減少 25 基點，對本公司 2024 及 2023 年度之稅前淨利將分別增加／減少新臺幣 51,542 仟元及新臺幣 23,496 仟元。

2. 匯率：

本集團係以美金、日圓、馬幣及越南盾為功能性貨幣，主要銷售及採購皆為美元計價，另所持有其他幣別做為各子(分)公司之日常營運資金所需。本公司 2024 及 2023 年度兌換(損)益分別為新臺幣(18,598)仟元及新臺幣 24,516 仟元，佔年度營業收入比率分別為 0.04%及 0.08%，對本公司營運及獲利無重大影響。

本集團目前尚無重大的匯率波動風險，然申請在臺上市掛牌之開曼控股公司預料未來可能因在國內籌資取得新臺幣資金後必須兌回美金使用，將會有美元對臺幣的匯率變動風險，本公司財務部門可能採取之因應措施如下：

- (1)財務人員依據匯率未來走勢於適當時機維持適當之外匯部位，以提供集團內各子公司之營運所需，降低匯率變動對本公司獲利之影響。
- (2)與主要往來銀行保持密切聯繫，隨時監控外匯市場之變化，以供相關主管人員充分掌握匯率變動趨勢，若因應偶發收付款幣別改變之情事可即時進行適時調節。
- (3)對外貨幣風險採取自然沖銷原則（即外銷與進口全部以美元計價），並視需要在適當時機運用遠期外匯合約以及舉借外幣債務等方式，以降低匯兌變化對公司損益的影響。

3. 通貨膨脹/緊縮：

本公司所需之原物料價格穩定，短期的通貨膨脹情形，對本公司未來損益之影響並不大。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司向以穩健經營為原則，並以財務健全為發展前提，最近年度並未從事高風險、高

槓桿投資及衍生性商品交易之情事。資金貸予及背書保證交易皆依據本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」所訂定之相關規定執行，迄今並無發生虧損。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

為因應未來的成長，本公司將持續投入研發資源發展先進製程系統單晶片(SoC)與客製化電路矽智財(IP)之設計研發，主要研發項目包括：低功耗設計流程(Low Power Design Flow)、時脈電路(Clocking Optimization)自動優化技術、信號完整性(Signal Integrity)管理技術、客製化電路矽智財設計開發(例如高速行動產業處理器介面(MIPI)電路之設計開發)、高階微處理器及其周邊矽智財之效能提升，以及高階多晶片封裝設計技術等。

本公司 2024 年及 2023 年研發費用金額分別為新臺幣 2,141,874 仟元及新臺幣 1,546,585 仟元，均有臺幣上億元之水準。未來將視產品開發計畫持續投入研發資源。惟本公司未來若未持續投入研發資源，產品發展及相關研發計畫將受限，或將使本公司無法滿足市場潮流或客戶需求，進而發生訂單流失之可能，本公司之營運將產生重大不利影響。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司註冊地國為開曼群島，開曼群島係以金融服務為主要經濟活動，經濟開放且無外匯管制，政經環境穩定。主要營運地國則為臺灣及中國，各項業務之執行均依照各營運地國主管機關法令規定辦理，最近年度及截至刊印日止，本公司尚無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司一向著重研發能力之提升，目前設計及生產之晶片多數為 16 奈米或以下製程之產品，預期中長期尚無因科技改變或產業變化而對公司財務業務產生重大不利影響。

1. 資訊技術安全之風險及管理措施

世芯電子已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，但無法保證其控管或維持公司製造營運及會計等重要企業功能之電腦系統能完全避免來自任何協力廠商癱瘓系統的網路攻擊。這些網路攻擊以非法方式入侵世芯電子的內部網路系統，進行破壞公司之營運及損及公司商譽等活動。在遭受嚴重網路攻擊的情況下，世芯電子的系統可能會失去公司重要的資料。世芯電子透過持續檢視和評估其資訊安全規章及程式，以確保其適當性和有效性，但不能保證公司在瞬息萬變的資訊安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響。網路攻擊也可能企圖竊取公司的營業祕密及其他機密資訊，例如客戶或其他利害關係人的專有資訊以及世芯電子員工的個資。

惡意的駭客亦能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體導入世芯電子的網路系統，以干擾公司的營運、對世芯電子進行敲詐或勒索，取得電腦系統控制權，或窺探機密資訊。這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷訂單而需賠償客戶的損失；或需擔負龐大的費用實施補救和改進措施，以加強公司的網路安全系統；也可能使世芯電子因涉入公司對其有保密義務之員工、客戶或協力廠商資訊外洩而導致的相關法律案件或監管調查，而承擔重大法律責任。

世芯電子為了預防及降低此類攻擊所造成的傷害，落實相關改進措施並持續更新，例如每週進行掃毒機制以防止內含惡意軟體進入公司，強化網路防火牆與網路控管以防止電腦病毒跨機台及跨場域擴散，依電腦類型建置端點防毒措施，定期偵測與處理惡意軟體，定期備份資料加強資料保護，加強釣魚郵件偵測，定期執行員工警覺性測試及釣魚郵件實例宣導。雖然世芯電子持續加強資訊安全防護措施，但仍無法保證公司免於惡意軟體及駭客攻擊。

此外，世芯電子需要分享高度敏感及機密的資訊給部分提供本公司及全球關係企業服務的協力廠商，以使其能提供相關服務。儘管世芯電子在和協力廠商簽訂之服務合約中，要求其遵守保密及/或網路安全規定，但不能保證每個協力廠商都將嚴守這

些義務。由上述服務廠商及/或其承攬商所維護的內部網路系統及外部雲端運算網路（例如伺服器），亦會有遭受網路攻擊的風險。若世芯電子或其服務廠商無法及時解決這些網路攻擊所造成的技術性問題，或確保世芯電子（及屬於本公司客戶或其他協力廠商）的數據完整性及可用性，或控制住公司或其服務廠商的電腦系統，皆可能嚴重損及世芯電子對客戶和其他利害關係人的承諾，而公司營運成果、財務狀況、前景及聲譽亦可能因此遭受重大不利影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無此情形。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中：

本公司主要原料為晶圓(Wafer)，主要向台灣積體電路製造股份有限公司(以下簡稱台積電)採購，確實有進貨集中現象。由於本公司並未與晶圓代工廠簽訂長期供貨合約，若晶圓代工廠未給予充足之產能支援，本公司可能發生供貨短缺或中斷之風險。惟本公司針對晶圓產能採取與廠商策略聯盟以及業務結合的關係，適時提供產品在市場上最新應用趨勢及產品預估銷售量，以便晶圓廠能夠及時支援產能需求，同時每月取得台積電半年以上的產能計畫以供生產備料所需；另本公司已建立第二供貨來源(second source)，以增加供貨來源之機動性，避免供貨短缺或中斷之情事。

2. 銷貨集中：

本公司 2024 年兩大銷售客戶銷貨比重分別為 60.16%及 21.18%。本公司持續致力於新客戶之開拓，分散客源，其效益預計將於 2025 年顯現。

(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：截至年報刊印日止，本公司董事之股權亦無大量異動，對本公司經營風險、財務、業務尚無重大影響。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日為止，本公司並無此情形。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

1. 公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

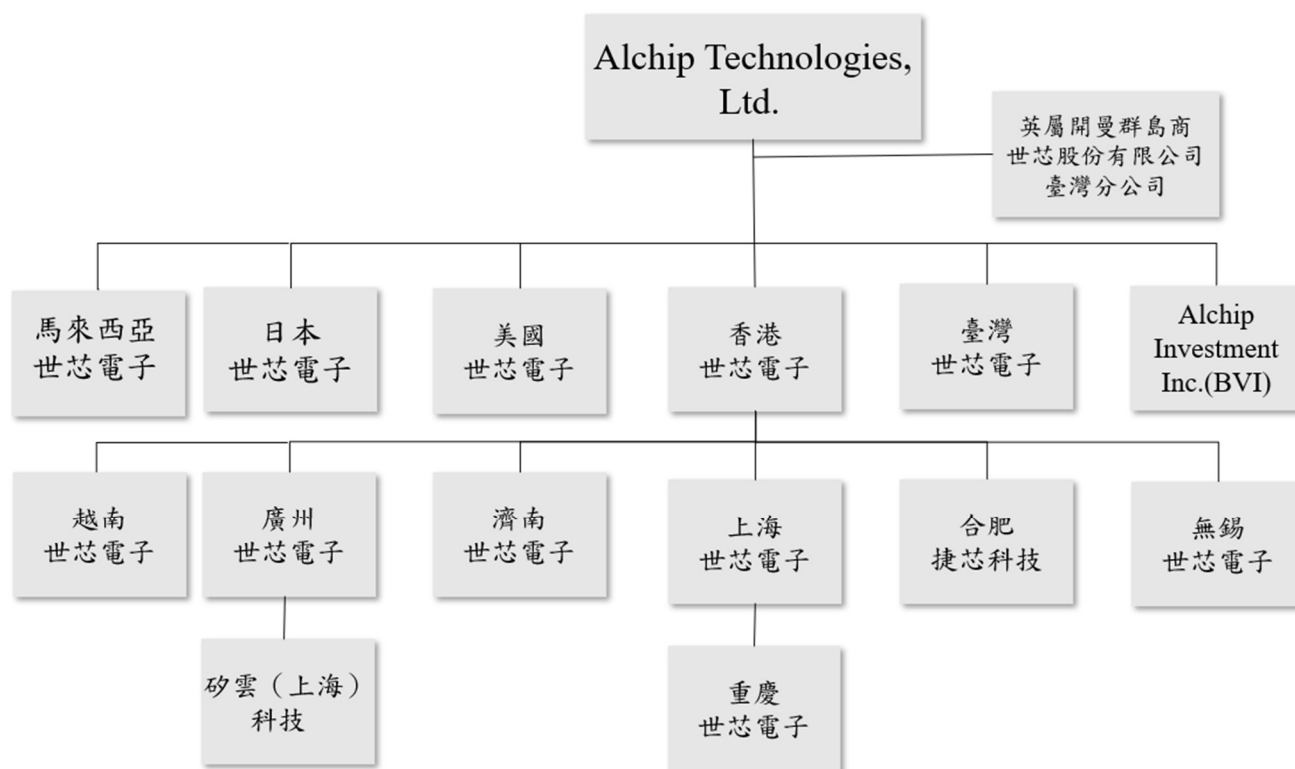
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖



2. 各關係企業基本資料

2024 年 12 月 31 日；單位:仟元

企業名稱	主要營業項目	設立日期	地址	實收資本額
香港世芯電子	一般投資	2002 年	香港	US\$19,129
美國世芯電子	提供產品技術支援及諮詢服務	2003 年	美國	US\$3,910
日本世芯電子	提供產品技術支援及諮詢服務	2004 年	日本	YEN100,000
臺灣世芯電子	提供 ASIC 及 SoC 服務	2005 年	臺灣	NT\$100
Alchip BVI	一般投資	2015 年	英屬維京群島	US\$41,836
上海世芯電子	研究、開發及設計 ASIC 及 SoC 並提供相關服務	2002 年	中國大陸	US\$12,800
無錫世芯電子	研究、開發及設計 ASIC 及 SoC 並提供相關服務	2012 年	中國大陸	US\$2,000
合肥捷芯科技	研究、開發及設計 ASIC 及 SoC 並提供相關服務	2016 年	中國大陸	US\$500
濟南世芯電子	研究、開發及設計 ASIC 及 SoC 並提供相關服務	2018 年	中國大陸	US\$784
廣州世芯電子	研究、開發及設計 ASIC 及 SoC 並提供相關服務	2020 年	中國大陸	US\$1,600
重慶世芯電子	研究、開發及設計 ASIC 及 SoC 並提供相關服務	2021 年	中國大陸	RMB5,000
矽雲(上海)科技	軟件開發及服務與 ASIC 及 SoC 設計並提供相關服務	2021 年	中國大陸	RMB10,000
馬來西亞世芯電子	研究、開發及設計 ASIC 及 SoC 並提供相關服務	2023 年	馬來西亞	US\$1,000
越南世芯電子	研究、開發及設計 ASIC 及 SoC 並提供相關服務	2024 年	越南	US\$1,000

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司整體關係企業皆從事專業特殊應用積體電路(Application Specific IC；ASIC)及系統單晶片(System-on-Chip；SoC)設計及製造生產業務。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

2024 年 12 月 31 日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
香港世芯電子	董事長	關建英	開曼世芯電子持有14,165,970 仟股	100%
	董事	關建英		
美國世芯電子	董事	沈翔霖 Shen,Johnny Shyang-Lin	開曼世芯電子持有391,000仟股	100%
	總經理	黃耀林		
日本世芯電子	董事長	古園 博幸 Furuzono, Hiroyuki	開曼世芯電子持有1仟股	100%
	總經理	古園 博幸 Furuzono, Hiroyuki		
	董事	古園 博幸 Furuzono, Hiroyuki		
	董事	藤田 浩三		
	董事	關建英		
	監察人	保坂純一郎		
臺灣世芯電子	董事長	關建英	開曼世芯電子持有10仟股	100%
	總經理	沈翔霖 Shen,Johnny Shyang-Lin		
	董事	關建英		
Alchip BVI	董事	王德善	開曼世芯電子持有50仟股	100%
	董事	詹舒媚		
上海世芯電子	董事長	林志堅	開曼世芯電子透過香港世芯電 子持有100%股權	100%
	總經理	林志堅		
無錫世芯電子	董事長	林志堅	開曼世芯電子透過香港世芯電 子持有100%股權	100%
	總經理	林志堅		
	董事	王德善		
	董事	鄭永力		
合肥捷芯科技	監事	沈翔霖 Shen,Johnny Shyang-Lin	開曼世芯電子透過香港世芯電 子持有100%股權	100%
	董事長	林志堅		
	總經理	林志堅		
	董事	王德善		
	董事	鄭永力		
濟南世芯電子	董事長	林志堅	開曼世芯電子透過香港世芯電	100%
	董事	沈翔霖 Shen,Johnny Shyang-Lin		

	總經理	林志堅	子持有100%股權	
	董事	王德善		
	董事	鄭永力		
	監事	沈翔霖 Shen,Johnny Shyang-Lin		
廣州世芯電子	董事長	林志堅	開曼世芯電子透過香港世芯電子持有100%股權	100%
	總經理	林志堅		
	董事	王德善		
	董事	鄭永力		
	監事	沈翔霖 Shen,Johnny Shyang-Lin		
重慶世芯電子	董事長	林志堅	開曼世芯電子透過上海世芯電子持有100%股權	100%
	總經理	林志堅		
	董事	鄭永力		
	董事	沈翔霖 Shen,Johnny Shyang-Lin		
	監事	黃建棋		
矽雲(上海)科技	董事長	廖雲濤	開曼世芯電子透過廣州世芯電子持有65%股權	65%
	總經理	廖雲濤		
	董事	桂寧		
	董事	鄭永力		
	董事	王德善		
	董事	林志堅		
	監事	黃建棋		
馬來西亞世芯電子	董事	王德善	開曼世芯電子持有100%股權	100%
	董事	鄭永力		
	董事	鄧建成		
	董事	CHAI SIEW LING		
越南世芯電子	董事長	王德善	開曼世芯電子透過香港世芯電子持有100%股權	100%
	董事	鄭永力		
	董事	鄧建成		

6. 各關係企業營運概況

2024 年 12 月 31 日；單位:新臺幣仟元

企業名稱	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益	每股 盈餘 (元)
香港世芯電子	2,829,572	171	2,829,401	-	(255)	1,016,534	-
美國世芯電子	72,022	35,363	36,659	166,612	(36,196)	(36,226)	-
日本世芯電子	193,737	77,696	116,041	550,464	9,308	13,051	-
臺灣世芯電子	432,131	21,109	411,022	-	(56,716)	(37,902)	-
Alchip BVI	1,479,284	-	1,479,284	-	(3,710)	6,883	-

上海世芯電子	2,097,787	315,569	1,782,218	2,217,629	648,444	782,240	-
無錫世芯電子	414,190	72,982	341,208	294,739	73,955	72,707	-
合肥捷芯科技	310,265	50,088	260,177	176,095	32,283	58,100	-
濟南世芯電子	301,190	89,680	211,510	291,531	71,925	78,450	-
廣州世芯電子	333,048	133,744	199,304	200,270	24,686	23,585	-
重慶世芯電子	410,524	219,697	190,827	452,143	127,473	151,177	-
矽雲(上海)科技	71,264	7,428	63,836	18,190	4,321	2,347	-
馬來西亞世芯電子	23,594	220	23,374	-	(9,342)	(9,215)	-
越南世芯電子	32,410	6	32,404	-	(350)	1,668	-

(二) 關係企業合併財務報告：與本公司合併財務報告相同，請至公開資訊觀測站參閱本公司合併財務報告，公開資訊觀測站連結：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>。

(三) 關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

項目	2023 年第二次私募 發行日期:2024 年 5 月 16 日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	股東會日期:2023 年 6 月 9 日 不超過 5,000,000 股額度內，將於股東會決議之日起一年內，分一次或二次辦理				
價格訂定之依據及合理性	(1)以 2024 年 5 月 14 日為訂價日。本公司以定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之： A. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為 2,520 元、2,565 元及 2,645 元，選擇前一個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為 2,520 元。 B. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為 2,978 元。 (2)以上列兩基準較高者 2,978 元為參考價格。經綜合考量後，將實際私募股票之每股認購價格訂為 2,382 元，為參考價格之 80%，未低於股東會決議之最低成數。				
特定人之選擇方式	依證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日（91）台財證一字第 0910003455 號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。				
辦理私募之必要理由	考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及本公司與投資人間的業務關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。				
價款繳納完成日期	2024 年 5 月 16 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量(股)	與本公司關係	參與公司經營情形
	Amazon.com, Inc.	證券交易法第 43 條之 6	224,537	無	無
實際認購價格	每股新台幣 2,382 元				
實際認購價格與參考價格差異	實際認購價格 2,382 元，為參考價格 2,978 元之 8 成。				

辦理私募對股東權益影響	本次私募普通股，占實收資本額 0.28%，對現有股東權益之影響不大。
私募資金運用情形及計畫執行進度	於 2024 年 5 月 16 日募集完成，募集所得之資金為新台幣 534,847,134 元，用於充實營運資金，已於 2024 年第二季全數執行完畢。
私募效益顯現情形	充實本公司長期營運發展所需之營運週轉金。

項目	2024 年第一次私募 發行日期:2024 年 11 月 15 日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	股東會日期:2024 年 5 月 30 日 不超過 1,000,000 股額度內，將於股東會決議之日起一年內一次或分次(最多不超過三次)辦理。				
價格訂定之依據及合理性	(1)以 2024 年 11 月 1 日為訂價日。本公司以定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之： A. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為 2,040 元、1,945 元及 1,939 元，選擇前一個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為 1,939 元。 B. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為 2,034 元。 (2)以上列兩基準較高者 2,034 元為參考價格。經綜合考量後，將實際私募股票之每股認購價格訂為 1,627 元，為參考價格之 80%，未低於股東會決議之最低成數。				
特定人之選擇方式	依證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日（91）台財證一字第 0910003455 號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。				
辦理私募之必要理由	考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。				
價款繳納完成日期	2024 年 11 月 14 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量(股)	與本公司關係	參與公司經營情形
	聯發資本股份有限公司	證券交易法第 43 條之 6	450,000	無	無
	ACPF B Limited	證券交易法第 43 條之 6	150,000	非本公司之關係人，惟本公司持有應募人之母公司(Achi Capital Fund Partners LP) 1.93%之股權	無
實際認購價格	每股新台幣 1,627 元				
實際認購價格與參考價格差異	實際認購價格 1,627 元，為參考價格 2,034 元之 8 成。				
辦理私募對股東權益影響	本次私募普通股，占實收資本額 0.75%，對現有股東權益之影響不大。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	於 2024 年 11 月 15 日募集完成，募集所得之資金為新台幣 976,200,000 元，用於充實營運資金，已於 2024 年第四季全數執行完畢。				
私募效益顯現情形	充實本公司長期營運發展所需之營運週轉金。				

三、其他必要補充說明事項：無。

四、本公司章程與我國股東權益保障規定重大差異之說明

(一) 公司章程或組織文件中訂定保障股東權益行使之具體內容與臺灣法規有關股東權益保護重要事項差異處：

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法相關規定	公司章程規定及差異原因
壹、公司資本之形成及變動			
1. 公司非依股東會決議減少資本，不得銷除其股份；減少資本，應依股東所持股份比例減少之。	公司法第 168 條	1.開曼公司法第 14 條允許公司得減少已發行之資本，但須經股東會以特別決議 (Special Resolution) 之方式，並經開曼法院確認為之。	公司章程第 10.7 條與左列股東權益保護重要事項略有差異，蓋於開曼公司法下，已發行股份之減少需經股東會以特別決議之方式，並經開曼法院確認為之。有鑑於此，公司章程第 14.1 條、第 10.7 條規定公司減少資本之程序，係透過股份買回之方式為之，此等差異係因開曼公司法規定所生，惟公司章程並未對公司減少資本之程序加以限制，故該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
2. 公司減少資本，得以現金以外財產退還股款；其退還之財產及抵充之數額，應經股東會決議，並經該收受財產股東之同意。		2.除開曼公司法第 14 條外，公司已發行之資本，只有在公司根據開曼公司法第 37 條或第 37B 條之規定，買回、繳回或回贖時，才可消除。	
3. 前項財產之價值及抵充之數額，董事會應於股東會前，送交中華民國會計師查核簽證。		3.開曼公司法第 37 條規定，公司得依公司章程或經由股東會決議之方式及條件，買回自身股份。除第 37 條之規定外，開曼公司法並無規定：(1)應依股東持股之比例予以買回，(2)以現金以外之財產退還股款時應經批准，或(3)對退還之財產價值應經評估。但得依公司章程加以規定。	
1. 公司與員工簽訂認股權契約或發行員工認股權憑證之程序。	公司法第 167 條之 2	開曼公司法並未就員工認股權契約或發行員工認股權憑證之程序等事項，訂有特別規定。發行員工認股權憑證及該憑證得否轉讓等，應於員工認股權契約或認股權憑	雖公司章程第 11.1 至 11.4 條已經依據左列股東權益保護重要事項進行修正，惟依開曼法律之規定，若欲限制員工認股權憑證之轉讓，仍應於員工認股權契約或認股權
2. 員工認股權憑證不得轉讓，但因繼承者不在此限。			

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相 關規定	公司章程規定及差異原因
		證中訂定之。	憑證中訂定之。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
貳、股東會之召集程序與決議方式			
1. 股東會每年至少須召集一次；應於每會計年度終了後六個月內召開。股東會由董事會召集之。	1. 公司法第 170 條 2. 公司法第 172 條之 1 3. 公司法第 172 條之 2 4. 公司法第 173 條第 1 項、第 2 項 5. 公司法第 172 條、證券交易法第 26 條之 1、第 43 條之 6 6. 公司法第 173 條之 1	1.(a)開曼公司法第 58 條規定，除豁免公司(exempted company)外，每家公司每年應至少召開一次股東大會。 (b)開曼公司法並未強制規定豁免公司應召開股東常會，公司得自行於其章程中規定公司每年應召開股東會之次數。 2.開曼公司法並未限制豁免公司之股東會應於特定期點召開，但得以公司章程加以規定。 3.開曼公司法對於股東召集股東會或股東提案權並無規定，相關程序得訂定於章程中。 4.開曼公司法對股東會通知內容並無規定，但得以公司章程加以規定。 5.開曼公司法並未規定股東會召集之細節，相關程序得以章程加以規定。	外國發行人係開曼法律下之豁免公司，依開曼公司法之規定，雖無必要每年召開股東大會，惟已於公司章程第 16.2 條規定：「公司應於每一會計年度終了後六個月內召開一次股東會作為年度股東常會，並應在股東會召集通知中詳細說明。董事會應於股東會作相關報告(如有)」。
2. 公司章程得訂明股東經中華民國公司法主管機關公告之方式為之。但因天災、事變或其他不可抗力情事，中華民國公司法主管機關得公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，以視訊會議或其公告之方式開會。			其他事項分別規定於公司章程第 16.2、16.3、16.4、18.9 條、16.5 至 16.8、及 17.5 條。
3. 股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。			
4. 有關股東會以視訊會議為之，公司應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，應遵循中華民國證券法令規定。			依據臺灣證券交易所 99 年 4 月 13 日臺證上字第 0991701319 號函：「說明：二、(三)外國發行人於不抵觸註冊地法令之前提下，應於章程訂定少數股東請求召集股東臨時會之權，至許可召集之主管機關部分，應可刪除。」故公司章程第 16.8 條規定：「如董事會於前述股東提出請求日起十五日內未為股東臨時會召集之通知者，則提出請
5. 公司召開實體股東會應於中華民國境內為之。若於中華民國境外召開實體股東會，應於董事會決議或股東取得主管機關召集許可後二日內申報證券交易所同意。			

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
6. 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面或電子受理事方式向公司提出股東常會議案。除議案非股東會所得決議、提案股東持股未達百分之一、議案於公告受理期間外提出、議案超過三百字或提案超過一項者外，董事會應列為議案。股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 7. 股東繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上者，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會。請求提出後十五日內，董事會不為召集之通知時，股東得報經主管機關許可，自行召集。 8. 繼續三個月以上持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會。股東持股期間及持股數之計算，以停止股票過戶時之持股為準。 9. 下列事項，應在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知：			求之股東得依據公開發行公司法令規定自行召集股東臨時會。」。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令 相關規定	公司章程規定及差異原因
(1) 選任或解任董事； (2) 變更章程； (3) 減資； (4) 申請停止公開發行； (5) 公司解散、合併、股份轉換、分割； (6) 締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經常共同經營之契約； (7) 讓與全部或主要部分之營業或財產； (8) 受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響者； (9) 私募發行具股權性質之有價證券。 (10) 董事從事競業禁止行為之許可； (11) 以發行新股方式，分派股息及紅利之全部或一部分； (12) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積，以發行新股或現金方式，分配與原股東者。			
1. 公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一。 2. 公司以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會	1. 公司法第 177 條之 1 2. 公司法第 177 條之 2	1. 股東不得以書面或電子方式於股東會行使其投票權。但如公司章程有明訂者，股東得以書面或電子方式委任代理人在會議中	公司章程第 19.6 條係規定：「以前述方式行使表決權的股東應被視為已指派股東會主席為其代理人，並依書面或電子文件中之指示，在

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令 相關規定	公司章程規定及差異原因
召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。 3. 股東以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 4. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 5. 股東以書面或電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。		行使其股份之投票權。 2. 股東如透過代理人行使其表決權者，不會被視為親自出席股東會。 3. 公司章程中得訂定交付委託書之規定。 4. 開曼公司法並無股東撤銷委託書之規定。但根據普通法之原則，不論公司章程有無任何相反之規定，親自出席股東大會進行表決的股東應有優先效力。但公司章程仍得訂定非由股東親自出席股東大會時有關撤銷委託之相關規定。	股東中行使其股份之表決權」。開曼法律雖認為透過此種方式行使表決權之股東將不會被視為親自出席股東會，但該股東實質上仍得享有依據中華民國法令以書面或電子方式行使表決權股東之所有權利，對公司股東之權益應無重大不利影響。
股東會之召集程序或其決議方法，違反法令或章程時，股東得訴請法院撤銷其決議，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。	公司法第 189 條	公司章程加入此種規定，在開曼法律下可能無法被執行，因為開曼法院無法在未重新檢視系爭糾紛之法律依據前，承認及執行一個非金錢給付之外國判決。	公司章程第 18.7 條規定：「章程任何內容不得妨礙任何股東向有關轄權之法院提起訴訟，以尋求股東會召集程序不當或決議不當有關的適當救濟，因前述事項所生之爭議得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。」該規定與左列股東權益保護重要事項略有差異。左列

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令 相關規定	公司章程規定及差異原因
			股東權益保護重要事項實為股東法定撤銷訴權之規定，其法律效果並非章程規定所能達成，需有法律規定賦予股東此項撤銷訴權。公司章程第 18.7 條之規定，雖與左列股東權益保護重要事項之規定略有不同，然如股東會之召集程序或決議方法有違反法令或章程時，公司章程並未限制股東向法院提起訴訟或救濟之權利，至於法院是否受理，及受理之法院是否撤銷該召集程序或決議方法違反法令或公司章程之股東會決議，則應由該法院（不論係中華民國或開曼或其他有管轄權國家之法院）審酌其所應適用之法律，是否有賦予股東撤銷訴權，並依其職權裁判之。此等差異係因股東撤銷訴權本質所致，且公司章程並未限制股東向法院提起訴訟或救濟之權利。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
1. 股東會決議下列事項之一時，異議股東對公司應有股份收買請求權： (1)公司分割、合併、收購或股份轉換； (2)公司締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人	1. 公司法第 317 條、第 186 條 2. 企業併購法第 12 條	開曼公司法第 238 條設有異議股東權(Rights of dissenters)規定。	公司章程第 22.3 條與左列股東權益保護重要事項略有差異，蓋開曼公司法第 238 條原即設有異議股東權利之相關規定，故除將左列股東權益保護重要事項列入公司章程第 22.2 條及第 22.3 條外，並於

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令 相關規定	公司章程規定及差異原因
經常共同經營之契約、讓與全部或主要部分之營業或財產、或受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響。 2. 股東為前項之請求，應於股東會議決之日起二十日內以書面提出，並列明請求收買價格。股東與公司間就收買價格達成協議者，公司應自股東會決議日起九十日內支付價款。未達成協議者，公司應自決議日起九十日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。 3. 於股東會投票反對或放棄表決權之股東，得依第一項第一款所訂事由向公司請求收買其所有之股份，如股東與公司間就收買價格自股東會決議日起六十日內未達成協議者，公司應於此期間經過後三十日內，以全體未達成協議之股東為相對人，聲請法院為價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。 4. 前項放棄表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。			章程第 22.3 條末段規定，異議股東依開曼公司法第 238 條所得行使之權利不因本條章程規定而受影響。此等差異係因開曼公司法規定所生，且此係使異議股東同時享有左列股東權益保護事項及開曼公司法第 238 條之保障，故該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
下列涉及股東重大權益之議案，應有	1. 公司法第 185 條	1. 依據開曼公司法第 60 條之規定，	1. 公司章程第 1.1 條

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相 關規定	公司章程規定及差異原因
代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數同意為之。出席股東之股份總數不足前述定額者，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之： 1. 公司締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與其他人經常共同經營之契約、讓與全部或主要部分之營業或財產、受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者 2. 變更章程 3. 章程之變更如有損害特別股股東之權利者，另需經特別股股東會之決議 4. 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部 5. 解散、合併或分割之決議 6. 股份轉換	2. 公司法第 277 條 3. 公司法第 159 條 4. 公司法第 240 條 5. 公司法第 316 條 6. 企業併購法第 29 條	特別決議(Special Resolution)係指於股東會上以投票方式進行表決者，經不低於有權於該股東會行使表決權並親自或委託代理人(如該股東會允許委託書)行使表決權之股東表決權數之三分之二(如章程訂有較高表決權數者，從其規定)之同意所為之決議。在一般開曼公司章程中，通常會規定該股東會通知應載明該議案應以特別決議為之。如經公司章程授權時，亦得以全體股東所簽署之書面決議，視為已作成特別決議。在需要以計票方式作為表決方式，以計算是否屬特別決議之多數決時，公司章程得規定每一股東所享有之表決權數。 2. 依開曼公司法之規定，應經特別決議之事項包括： (i) 變更公司名稱(第 31 條)； (ii) 修改或增訂公司章程(第 24 條)； (iii) 修改或增訂章程大綱有關宗旨、權力或其他特別載明之事項(第 10 條)； (iv) 減資及資本贖回準備金(第	(a) 公司章程規定 公司章程第 1.1 條規定，特別決議係指：「指經有權於該股東會行使表決權之股東表決權數三分之二以上同意之決議。該股東得親自行使表決權或委託經充分授權之代理人(如允許委託代理人，須於股東會召集通知中載明其為特別決議)代為行使表決權。」依據開曼法律意見書，應經特別決議之事項應包括但不限於：(i)變更公司名稱；(ii)修改或增訂公司章程；(iii)修改或增訂章程大綱有關宗旨、權力或其他特別載明之事項；(iv)減資及資本贖回準備金；(v)因無法於其債務到期時清償以外之事由，所為之自願解散者；及(vi)與其他公司合併(merger)或整合(consolidation)。另依公司章程第 18.1 條規定：「除出席股東代表股份數達到法定出席股份數，股東會不得為任何決議。除法令、章程或公開發行公司法另有規定外，代表已發行股份總數過半數之股東親自或委託代理人出席，

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相 關規定	公司章程規定及差異原因
		14 條及第 37(4)(d)條)； (v) 因無法於其債務到期時清償以外之事由，所為之自願解散 (第 90(b)(i) 條及第 116(c)條)。 (vi) 與其他公司合併(merger)或整合(consolidation)。 依開曼公司法須經特別決議之事項，不得以較低之多數決方式加以通過。 3.對於上述所列以外之事項，開曼公司法並未要求須達到某特定多數，但得以公司章程加以規定。	應構成股東會之出席法定權數。」亦即如欲作成公司之特別決議，至少須經代表該公司已發行股份總數過半數之股東親自或委託代理人出席，且以出席股東（包括以委託書委託代理人出席者）三分之二表決權數以上同意為之。 (b) 差異原因 依據開曼法律意見書，特別決議為開曼公司法之規定，且依開曼公司法之規定，應經特別決議之事項，不得以較低之多數決方式加以通過。又公司章程第 1.1 條中另對「特別 (重度) 決議」(Supermajority Resolution)加以定義，係指「(i) 由代表公司已發行股份總數三分之二或二分之一以上之股東（包括股東委託代理人）出席股東會，出席股東代表決議過半數同意通過的決議，或(ii)若出席股東會的股東代表股份總數雖未達公司已發行股份總數三分之二，但已超過公司已發行股份總數之半數時，由出席股東代表決議三分之二或以上之同意通過的決議

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令 關規定	公司章程規定及差異原因
			議。」 對於左列股東權益保護重要事項，如依據開曼公司法係應經特別決議者，則於公司章程中仍列為「特別決議」事項；否則，則列為「特別（重度）決議」事項。 2. 公司章程第 14.3 條（於 2018 年股東常會新版本通過後移為第 14.4 條） (a) 公司章程規定： 公司章程第 14.3 條規定：「在不違反法令、章程及公開發行公司法令之規定下，有關公司解散之程序：(a)如公司係因無法於其債務到期時清償而決議自願解散者，公司應以股東會特別（重度）決議為之；或(b)如公司係因前述第 14.3 條(a)款以外之事由而決議自願解散者，公司應以股東會特別決議為之」。 與左列股東權益保護重要事項略有不同之處在於：公司章程就解散之決議，係依其決議解散之事由，而分別列為「特別（重度）決議」及「特別決議」事項，相較於此，左列股東權益

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令 相關規定	公司章程規定及差異原因
			保護重要事項則要求以「一律要求以「特別(重度)決議」為之。 (b) 差異原因： 依據開曼法律意見書，依開曼公司法之規定，如公司係因無法於其債務到期時清償以外之其他事由而決議自願解散者，須以特別決議為之。由上可知，此等差異係因開曼法律所致。故公司章程規定「公司係因無法於其債務到期時清償而決議自願解散者」，應以特別(重度)決議為之；第14.3條(a)款以外之事由，則依開曼公司法之要求，列為「特別決議」事項。上開差異，是因開曼法令之限制所致，該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
參、董事、監察人之權限與責任 董事之報酬，未經章程訂明者，應由股東會議定，不得事後追認。	公司法第196條第1項	開曼公司法並未明文規定董事報酬如何決定，但得以公司章程加以規定。	公司雖未於章程中訂明董事報酬，或訂定應由股東會議訂之，惟參照經濟部民國93年3月8日商字第09302030870號解釋之意旨，以及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，公司董事會已設置薪資報酬委員會，故左列規定對

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相 關規定	公司章程規定及差異原因
董事執行業務，有重大損害公司之行為或違反法令或章程之重大事項者，股東會未為決議將其解任者，持有公司已發行股份總數百分之三以上之股東，得於股東會後三十日內訴請法院裁判解任之，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。	公司法第 200 條	1. 開曼公司法並未特別明文規定少數股東得向開曼法院聲請解任董事。 2. 一般而言，董事解任之程序係規定於公司章程中，且通常規定應經股東會普通決議。 3. 依據普通法關於股東救濟之規定，在一個指控董事對公司為侵害之訴訟中，形式上適格之原告應為公司本身，而非股東個人或少數股東。上述原則只有少數之例外情形，包括當董事之行為構成對少數股東詐欺時，且該等為詐欺行為之人係公司之控制者，則受詐欺之少數股東得向法院提起訴訟。 4. 公司章程中加入此等規定在開曼法律下可能無法被執行，因為開曼法院無法在未重新檢視系爭糾紛之法律依據前，承認及執行一個非金錢給付之外國判決。董事得以公司章程所規定之程序加以解任。	於公司股東權益應無重大不利影響。 (1) 公司章程規定： 公司章程第 28.2(j) 條規定：「除法令、章程或公開發行公司法另有規定，董事若在其執行職務期間所從事之行為對公司造成重大損害，或嚴重違反相關適用之法律及/或規章或章程大綱和章程，但未經公司依特別（重度）決議將其解任者，則持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東有權自股東會決議之日起三十日內，以公司之費用，訴請有管轄權之法院解任該董事，而該董事應於該有管轄權法院為解任董事之終局判決時被解任之。為免疑義，倘一相關法院有管轄權而得於單一或一連串之訴訟程序中判決前所有事由者，則為本條款之目的，終局判決應係指該有管轄權法院所為之終局判決。」與左列之股東權益保護重要事項略有差異。 (2) 差異原因： 由於開曼公司法並未明文規定允許少數股東得向開曼法院申

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令 相關規定	公司章程規定及差異原因
人應即通知董事會或董事停止其行為。 8. 監察人各得單獨行使監察權。 9. 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員。			
1. 繼續六個月以上持有公司已發行股份總數百分之十以上之股東，得以書面請求監察人為公司對董事提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。 2. 股東提出請求後三十日內，監察人不提起訴訟時，股東得為公司提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。 3. 監察人除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。	公司法第 200、214、220、227 條。	1. 開曼公司法並無相當於「監察人」之概念。 2. 依據普通法關於股東救濟之規定，在一個指控董事對公司為侵害行為之訴訟中，形式上適格之原告應為公司本身，而非股東個人或少數股東。上述原則只有少數之例外情形，包括當董事之行為構成對少數股東詐欺時，且該等為詐欺行為之人係公司之控制者，則受詐欺之少數股東得向法院提起訴訟。 3. 公司章程中加入此等規定在開曼法律下可能無法被執行，因為開曼法院無法在未重新檢視系爭糾紛之法律依據前，承認及執行一個非金錢給付之外國判決。	公司章程第 25.6 條。 依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第 28-4 條第 2 項前段規定：「外國發行人應擇一設置審計委員會或監察人」。公司已設置由全體獨立董事組成之審計委員會取代監察人。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
董事或監察人(設置監察人公司適用)以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數。	公司法第 197 條之 1、227 條。	開曼公司法並未規定(於何種情形下)董事所持有之股份無表決權，但得以公司章程加以規定。	公司章程第 24.3 條。 另，依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第 28-4 條第 2 項前段規定：「外國發行人

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令 關規定	公司章程規定及差異原因
			應擇一設置審計委員會或監察人」。公司已設置由全體獨立董事組成之審計委員會，故無需另設置監察人。因此，前述章程之規定並不包括監察人在內。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
1. 公司之董事應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任。該行為若係為自己或他人所為時，股東會得以決議，將該行為之所得視為公司之所得。 2. 公司之董事對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。 3. 公司之經理人、監察人在執行職務範圍內，應負與公司董事相同之損害賠償責任。	公司法第8條第2項、第23條第3項、企業併購法第5條第1項、第2項	1. 開曼公司法並特別規定董事之義務為具體規範。依據開曼之普通法，董事應對公司負(1)受託人義務(fiduciary duties)，以及(2)善良管理人之注意義務(duty of care)。公司得向違反上述義務之董事請求賠償。此外，若董事違反其義務並因此獲得利益者，公司得將該利益歸於公司。 2. 根據普通法之原則，在管理公司業務的經營過程中，董事代表公司所為之行為將視為公司本身之行為。若其行為造成任何第三人之損害，應由公司而非由該董事，就其行為對該第三人負責。請求損害賠償之第三人並無須依據公司章程之規定請求及加諸義務於董事，非股東之第三人並無須依據公司章程而為執行。公司因董事違反義務而須對第三人負損害賠償責任時，公司得	公司章程第26.5條。 惟董事對於公司業務之執行，如有違反該法定義務致他人受有損害時，該他人在開曼法律下不一定得直接對該董事訴訟賠償，即使在公司章程中訂定董事對他人應與公司負連帶賠償責任者，亦無法創設該項請求權基礎。 此外，雖公司章程第26.5條已經規定該條義務於經理人亦有適用，惟依開曼法律應以契約方式與經理人約定。因此，若欲貫徹左列股東權益保護事項對於經理人之責任，應由公司與經理人以契約加以約定。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相 關規定	公司章程規定及差異原因
		向造成損害之董事請求賠償。 3. 經理人一般而言對公司並無受託人義務。因經理人並非章程之當事人，所以即使以章程加以規定，仍將不具執行力。上述義務應以契約方式與經理人約定。	
法人為股東時，得由其代表人當選為董事或監察人。代表人有數人時，得分別當選，但不得同時當選或擔任董事及監察人。	公司法第 27 條第 2 項	1. 開曼公司法並未就法人股東之代表人當選董事為規範，但得以公司章程加以規定。 2. 開曼公司法並未無相當於「監察人」之概念。	公司章程第 27.4 條。 復依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第 28-4 條第 2 項前段規定：「外國發行人應擇一設置審計委員會或監察人」。公司已設置由全體獨立董事組成之審計委員會取代監察人。因此，前述章程之規定並不包括監察人在內。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。

五、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司



董事長 關建英



地址：台北市114內湖區文湖街12號9樓

電話：(02)2799-2318



英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司
Alchip Technologies, Limited